

電子機器2023 トータルソリューション展

www.jpccashow.com



JPCA 2023 Show
第52回国際電子回路産業展

JIEP マイクロエレクトロニクスショー
第37回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2023
第24回 実装プロセステクノロジー展

SDGsデバイス展
SDGsデバイス展

WIRE Japan Show
～装置と装置をつなぐ～
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展

Smart Sensing
スマートセンシング

無人化ソリューション展
無人化ソリューション展

Edge Computing
エッジコンピューティング

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION
InterOpto
インターオプト

Imaging Japan
イメージングジャパン

結果報告書

出展者数: **517社** 小間数: **1,273小間** / 来場者数 **48,018名**

2023.5.31_{Wed.} → 6.2_{Fri.} 10:00-17:00

東京ビッグサイト 東展示棟 2~6ホール+会議棟

www.jpccashow.com

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2023 (JPCA Show、マイクロエレクトロニクスショー、JISSO PROTEC、SDGsデバイス展、WIRE Japan Show、Smart Sensing、無人化ソリューション展、Electronics Component & Unit Show、E-Textile/Wearable、interOpto、Imaging Japan、Edge Computing)」は、2023年5月31日(水)～6月2日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数517社、出展小間数1,273小間で盛況裡に無事終了することができました。

これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省をはじめ、協賛団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2024年6月12日(水)～6月14日(金)「電子機器トータルソリューション展2024」を東京ビッグサイト 東展示棟で予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果をご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

実施概要



展示会運営委員会
委員長
山本 治彦



(一社)日本電子回路工業会
会長
小林 俊文



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長
藤崎 晃



(一社)日本ロボット工業会
会長
山口 賢治



(株)産業タイムズ社
代表取締役会長
泉谷 渉



(株)工業通信
代表取締役社長
井上 政基



全国電子部品流通連合会
会長
屋宮 芳高



株式会社JTBコミュニケーションデザイン
代表取締役 社長執行役員
古野 浩樹



(株)織研新聞社
代表取締役社長
佐々木 幸二



(一財)光産業技術振興協会
副理事長 専務理事
小谷 泰久

■ 会 期：2023年5月31日(水)～6月2日(金)

■ 開催時間：10:00～17:00

■ 会 場：東京ビッグサイト 東2～6ホール+会議棟

■ 名 称：**JPCA Show 2023 第52回国際電子回路産業展**

構成展示会：2023 プリント配線板技術展
2023 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
2023 機器・半導体受託生産システム展
主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

JISSO PROTEC 2023

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

WIRE Japan Show 2023 電気・光伝送技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
電線新聞 ((株)工業通信)

E-Textile/Wearable イーテキスタイル/ウェアラブル展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社織研新聞社

無人化ソリューション展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

interOpto インターオプト

主 催 一般財団法人 光産業技術振興協会
企画・推進 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

2023 マイクロエレクトロニクスショー 第37回 最先端実装技術・パッケージング展

同時開催：最先端実装技術シンポジウム
アカデミックプラザ
eX-tech 2023
主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

SDGs デバイス展 2023

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
電子デバイス産業新聞 ((株)産業タイムズ社)

Electronics Component & Unit Show

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
全国電子部品流通連合会 / 東京都電機卸商業協同組合

Smart Sensing 2023 スマートセンシング

共 催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
一般社団法人日本電子回路工業会

Edge Computing エッジコンピューティング

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

Imaging Japan イメージングジャパン

共 催 一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

■ 後 援：経済産業省

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体：CPCA (中国電子回路産業協会)、EIPC (欧州電子回路協会)、ELCINA (印度電子工業会)、HKPCA (香港線路板協会)、IPC (米国電子回路協会)、IPCA (印度電子回路工業会)、KPCA (韓国電子回路産業協会)、THPCA (タイ電子回路工業会)、TPCA (台湾線路板協会)

KPIA (Korea Packaging Integration Association)、AEIS (Association of Electronic Industries in Singapore)

■ 本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会 (JPCA)

■ 協 賛：一般社団法人映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、一般社団法人画像電子学会、一般社団法人カメラ映像機器工業会、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、一般社団法人組込みシステム技術協会、公益社団法人自動車技術会、写真感光材料工業会、一般社団法人情報サービス産業協会、一般社団法人情報処理学会、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、SEMIジャパン、全国鍍金工業組合連合会、一般社団法人ソフトウェア協会、太陽光発電技術研究組合、一般社団法人電気学会、一般社団法人電気設備学会、一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人電子情報通信学会、銅箔工業会、一般社団法人日本アミューズメント産業協会、一般社団法人日本医療機器工業会、一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会、一般社団法人日本印刷産業連合会、一般社団法人日本オーディオ協会、一般社団法人日本音響学会、一般社団法人日本火災報知機工業会、一般社団法人日本金型工業会、一般社団法人日本金属熱処理工業会、一般社団法人日本計量機器工業連合会、一般社団法人日本検査機器工業会、一般社団法人日本材料科学会、一般社団法人日本産業機械工業会、一般財団法人日本自動車研究所、一般社団法人日本自動車部品工業会、一般社団法人日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、一般社団法人日本電気協会、一般社団法人日本電気計測器工業会、一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人日本電気制御機器工業会、一般社団法人日本照明工業会、一般社団法人日本電子デバイス産業協会、一般財団法人日本電子部品信頼性センター、一般社団法人日本電線工業会、一般社団法人日本配線システム工業会、一般社団法人日本半導体製造装置協会、一般社団法人日本表面処理機材工業会、公益社団法人日本表面真空学会、一般社団法人日本ファインセラミックス協会、公益社団法人日本分析化学会、一般社団法人日本分析機器工業会、一般社団法人日本ベアリング工業会、一般社団法人日本遊技関連事業協会、一般社団法人日本溶接協会、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会、一般社団法人表面技術協会、一般財団法人ファインセラミックスセンター、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会 (順不同・敬称略)

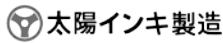
■ 展示会運営事務局：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

スポンサーシップ

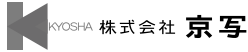
Platinum Sponsor



Gold Sponsor



Silver Sponsor



Bronze Sponsor



スポンサープログラムの主な内容

- 展示会場入口バナー広告またはガレリアデッキ下バナー広告
- ガレリア柱巻広告
- 公式サイトにスポンサー特集ページ掲載
- 会場フロアマップ、公式サイトトップページ、基調講演間のロゴ掲載
- 展示会メルマガへの広告掲載
- 来場者向けスタンプラリーの参加

展示会結果概要

展示会・セミナーともに大盛況!

出展者数

517
社・団体

小間数

1,273
小間

来場者数

48,018名

セミナー数

252本

広報活動

(1) 関連業界団体との連携強化

メールマガジンの配信や機関誌への広告掲載など相互の展示会においてプロモーション活動を実施。

(2) 広告掲載媒体 (順不同)

エレクトロニクス実装技術/メカトロニクス/プリント回路ジャーナル/電波新聞/電線新聞/化学工業日報/新製品情報/日刊工業新聞/科学情報出版HP/CEND/プロダクトナビ/製品ナビ/基板の窓口

(3) 海外展示会出展・広告掲載実績

2022年 9月21日(水)～23日(金) 韓国: KPCA Show 2022

10月26日(水)～28日(金) 台湾: TPCA Show 2022 (Taipei)

2023年 1月24日(火)～26日(木) 米国: IPC Apex Expo 2023

3月22日(水)～24日(金) 中国: 国際電子回路(上海) 展覧会 (CPCA Show)

(4) PRツール製作

国内用招待状(245,000枚)、海外用招待状(データ配布)、VIP招待券(27,000枚)、ポスター(800枚)

(5) メールマガジンの配信

関連する業界団体やスポンサー企業などの協力により、会期1ヶ月前よりメールマガジン配信を実施。

(6) メディア発表会の実施

昨年に引きつづき、開幕に先駆け、5月10日(水)にオンラインにてメディア発表会を実施し、10社11名のメディア関係者が参加。

開会式

●日 時：5月31日(水) 9:45～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 東3ホール前ガレリア

来賓	荻野 洋平	経済産業省 商務情報政策局 デバイス・半導体戦略室	室長
開催挨拶	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	展示会運営・企画委員長
	藤崎 晃	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	曾我 信之	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
	泉谷 涉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	奥野 晃治	株式会社JTBコミュニケーションデザイン	執行役員 事業共創部長
	屋宮 芳高	全国電子部品流通連合会	会長
	藤浦 修一	株式会社織研新聞社	執行役員
	小谷 泰久	一般財団法人光産業技術振興協会	代表理事
	GAO SUMEI	中国电子信息行业联合会 (CFEII)	会長
	Benny Yip	香港線路板協会 (HKPCA)	副会長
	David W. Bergman	米国電子回路協会 (IPC)	Vice President Standards & Technology
	Kim Jong Hak	韓国電子回路産業協会 (KPCA)	副会長
	Swaek Prakiritanon	タイ電子回路工業会 (THPCA)	会長
	Maurice Lee	台湾电路板協会 (TPCA)	会長
	HyunHo KIM	Korea Packaging Integration Association (KPIA)	会長

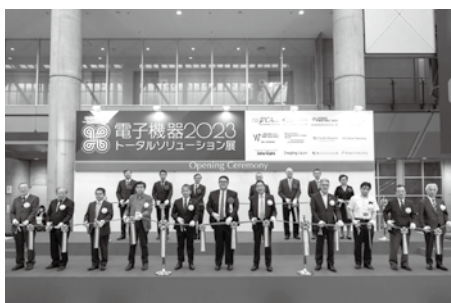
ウェルカムレセプション

出展企業及び業界関係者約500名が参加。御来賓として、西村 康稔 経済産業省 大臣にご挨拶をいただいた。

●日 時：5月31日(水) 17:30～18:30

●会 場：東京ビッグサイト レセプションホール

挨拶	小林 敏文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
来賓挨拶	西村 康稔	経済産業省	経済産業大臣
乾杯登壇	西村 康稔	経済産業省	経済産業大臣
	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	児嶋 一登	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	小島 正紀	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	倉田 司	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	展示会運営委員会・企画委員会委員長
	藤崎 晃	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	片岡 栄富司	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2023 運営委員長北口氏代理
	泉谷 涉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役会長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	奥野 晃治	株式会社JTBコミュニケーションデザイン	執行役員 事業共創部長
	屋宮 芳高	全国電子部品流通連合会	会長
	藤浦 修一	株式会社織研新聞社	執行役員
	小谷 泰久	一般財団法人光産業技術振興協会	代表理事
乾杯発声	片岡 栄富司	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2023 運営委員長北口氏代理
中締挨拶	藤崎 晃	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長



開会式テープカット



西村経済産業大臣のご挨拶



ウェルカムレセプション乾杯

出展者交流会

出展者様同士のネットワーキングを通じて、展示会への出展効果を高めることを目的として、新たに「出展者交流会」を開催した。

●日時：6月1日(木) 17:15～18:15

●会場：東京ビッグサイト展示ホール内交流会参加ブース



来場者参加型企画

主催者テーマ展示“新しい基板の用途”

2019年以来、4年ぶりの開催となる主催者テーマ展示では、先進技術がより身近に感じられ、生活に変化をもたらすユニークな製品、興味が湧いてくる製品が多数展示され、来場者のみならず出展者の方々からも好評いただける展示となった。本年も、(株)産業タイムズ社の特別協力を得て、「電子デバイス産業新聞」にて特集記事を掲載。

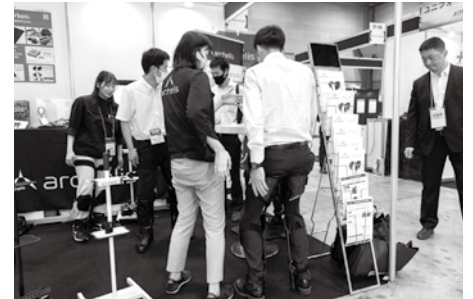
ガラス基板に高密度性が得られる無電解銅めっきプロセス：PLOPX	奥野製薬工業(株)
はんだ付け不要基板ジョイント 導通 技術 LED Cube	(有)ケイ・ビー・ディ
ストレッチャブル&紙基板実装	JOHNAN (株)
透明アンテナ基盤	シライ電子工業(株)
部品実装立体成形基盤「MID」	太陽インキ製造(株)
3D 電気回路	(株)電気印刷研究所
UHF 帯 RFID タグ “SmaCo®” シリーズ	日本ミクロン(株)
エレクトロニクス 3D プリンターで製造した電子基板	(株)FUJII
5G 通信帯対応 低誘電・高硬度コーティング LDP-DLC	(株)プラズマイオンアシスト
IH Reflow だから可能にした 3D-MID	(株)ワンダーフューチャーコーポレーション



ウェアラブル製品デモンストレーション展示

今後もさらなる市場拡大が見込まれ注目度の高い「ウェアラブル」製品のデモンストレーション展示では、ブースを訪れた来場者に「ウェアラブル」の技術を見て触れて、より身近に感じていただいた。

各種空調服関連	アイトス(株)
ウェアラブル用導電糸の活用事例紹介	ウラセ(株)
業務用ウェアラブルカメラ	(株)ザクティ
アルケリス FX	サンコロナ小田(株)
遠隔現場支援システム LiveOnWearable	ジャパンメディアシステム(株)
発光ジャガード織物「LightWeave®」	大喜(株)
メタバース触覚ウェア	東京大学
可撓性導波管	(株)米澤物産



来場者参加型企画

基板製造プロセス展示

プリント基板の製造プロセスを分かり易く分解したチャートとJPCA Showの関連出展者様の情報を展示。
入社間もない若手の方や学生の皆様にもわかりやすい内容とし、会場内ではナレーション付き動画のサイネージを設置し、また展示会HPにも掲載。



実装体験コーナー

工作キットを用い、簡単なはんだ付けを体験できるコーナーを設置。
半導体関連企業の新入社員や製造に携わる機会の少ない部署の社員の方などが参加いただいた。

<実施日時>

5月31日(水)	6月1日(木)	6月2日(金)
13:15~14:45	11:00~12:30	11:00~12:30
15:30~17:00	15:00~16:30	13:00~14:30



ブースコンテスト

前回に引き続きブースコンテストを実施した。
ブースコンテストは、出展企業の中から、ブースデザインの装飾を対象とした【ナイスデザイン賞】、展示内容のわかりやすさ、見やすさを対象とした【ベスト展示賞】、パッケージブースの効果的利用を対象とした【特別審査員賞】の3つの賞を設け、来場者投票により決定した。

表彰式

- 日 時：6月2日(金) 10:15~10:30
- 会 場：東2ホール セミナー会場F



ナイスデザイン賞・ベスト展示賞

【小間番号:6B-03】

太陽インキ製造株式会社

W受賞!



特別審査員賞

【小間番号:2A-13】

チューリップ株式会社



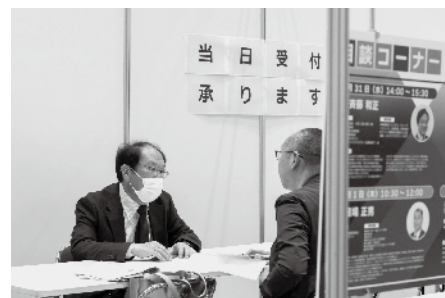
交流プラザ

学生の来場者に向け交流プラザを設置。そこでは展示会を楽しむためのみどころ紹介や学生の来場を積極的に受け付けている出展企業情報を提供した。
また、希望者には会場内のガイドツアー等を実施した。



相談コーナー

電子回路、専門加工、製造装置、センサ、他に関する技術的な相談やインターネットでは聞けない色々な疑問等にJPCA認定のPWBコンサルタントが専門的な視点でアドバイスするコーナーを設置した。



スタンプラリー

来場者がスポンサープログラム参加出展者ブースをスタンプラリー形式で巡り、各社製品・技術情報を入手しながら全て完了すると最後にノベルティーが貰えるという企画を実施。

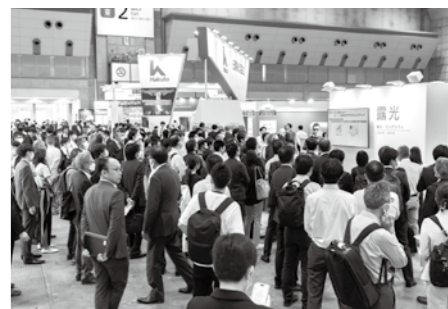
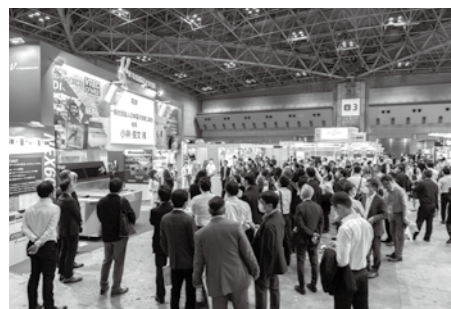
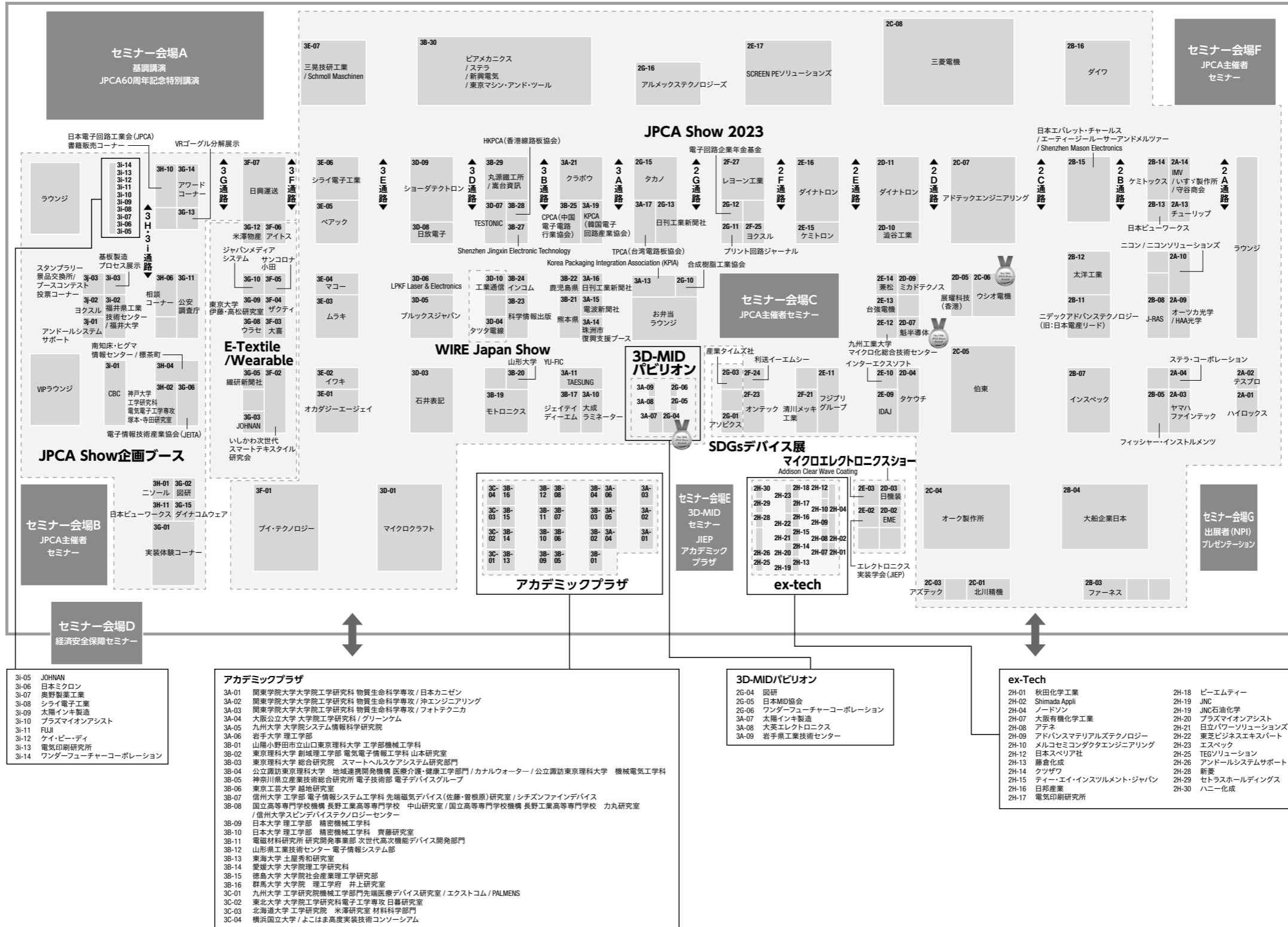
また、出展者から募集しノベルティーのご提供をいただいた。

ノベルティーご提供出展者

(株)ADEKA	レストラン山惣欧風ビーフカレー
アンドールシステムサポート(株)	ポケットティッシュ
(株)図研	ハンドミラー
ダイナコムウェア(株)	ポケット型クリアファイル
(株)ニソール	電子回路プリント基板定規
日本ビューワークス(株)	エコバッグ
ヨクスル(株)	デミクリップ
主催者提供	導電性指サック

東3ホール

東2ホール

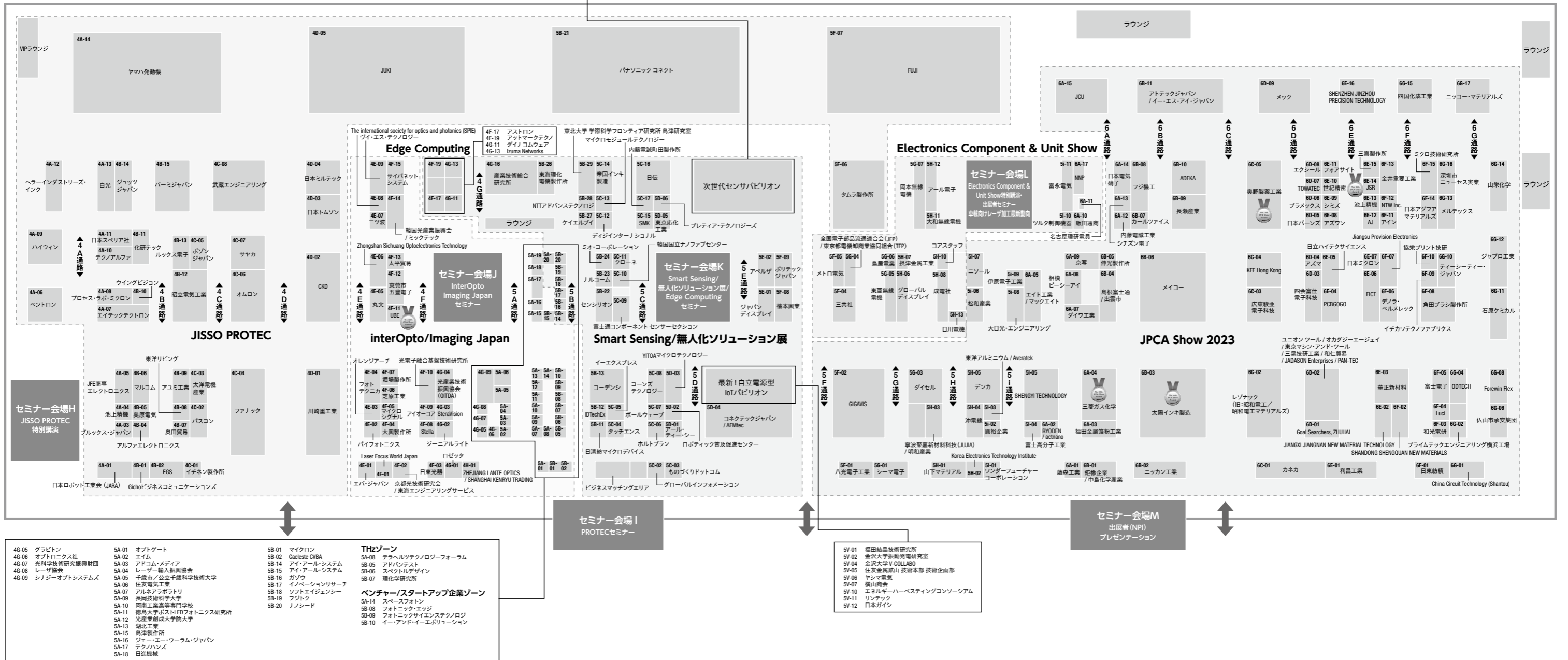


会場レイアウト

東4ホール

東5ホール

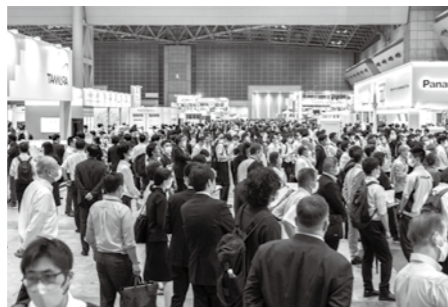
東6ホール



- 5E-03-1 MODE, Inc.
- 5E-03-2 神戸デジタル・ラボ
- 5E-03-3 マルティス・ブ
- 5E-03-4 泰興物産
- 5E-03-5 朝日ラバー
- 5E-03-6 マクセル
- 5E-03-7 デルタツツリング
- 5E-03-8 アルプスアルパイン
- 5E-03-9 リコー
- 5E-03-10 ImpactTV
- 5E-03-11 富士通コンポーネント 無線ネットワーク
- 5E-03-12 マクニカ アルティマカンパニー
- 5E-03-13 南陽

- 4G-05 グラビトン
- 4G-06 オプトロニクス社
- 4G-07 光科学技術研究振興財団
- 4G-08 レーザ協会
- 4G-09 シナジーオプトシステムズ
- 5A-01 オプトゲート
- 5A-02 エム
- 5A-03 アドコム・メディア
- 5A-04 レーザー輸入振興協会
- 5A-05 千歳市/公立千歳科学技術大学
- 5A-06 住友電気工業
- 5A-07 アルネアラボトラリ
- 5A-09 長岡技術科学大学
- 5A-10 阿南工業高等専門学校
- 5A-11 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所
- 5A-12 光産業創成大学院大学
- 5A-13 堀北工業
- 5A-15 島津製作所
- 5A-16 ジェー・エー・ウラム・ジャパン
- 5A-17 テクノハンス
- 5A-18 日進機械
- 5B-01 マイクロン
- 5B-02 Caletish OIRA
- 5B-14 アイ・アール・システム
- 5B-15 アイ・アール・システム
- 5B-16 ガソウ
- 5B-17 インベーションリサーチ
- 5B-18 ソフトエイジェンシー
- 5B-19 フジトク
- 5B-20 ナノシード
- THzゾーン**
- 5A-08 テラヘルツテクノロジーフォーラム
- 5B-05 アドバンテスト
- 5B-06 スペクトルデザイン
- 5B-07 理化研究所
- ベンチャー/スタートアップ企業ゾーン**
- 5A-14 スペースフォトン
- 5B-08 フォトニックエッジ
- 5B-09 フォトニックサイエンステクノロジー
- 5B-10 イー・アンド・イーエポリューション

- セミナー会場I**
PROTECセミナー
- セミナー会場M**
プレゼンテーション
- 5V-01 福田純島技術研究所
- 5V-02 金沢大学産業動電研究室
- 5V-04 金沢大学 V-COLLABO
- 5V-05 住友金属鉱山 技術本部 技術企画部
- 5V-06 ヤシマ電気
- 5V-07 横山商会
- 5V-10 エネルギー・ハーベスティングコンソーシアム
- 5V-11 リンテック
- 5V-12 日本ガイシ



出展者一覧

JPCA Show 2023

プリント配線板技術展

IMV	2A-14	三晃技研工業	3E-07	ニッカン工業	6B-02
IDAJ	2E-09	三晃技研工業	6D-02	日刊工業新聞社	3A-16
アイン	6F-11	CBC	3i-01	日興運送	3F-07
Averatek	5i-03	CPCA (中国電子回路行業協会)	3B-25	ニッコー・マテリアルズ	6G-17
鉅椽企業股份有限公司	6B-01	ジェイティディーエム	3B-17	日東紡績	6F-01
actnano	6A-02	J-RAS	2B-08	日放電子	3D-08
アズテック	2C-03	JCU	6A-15	ニデックアドバンステクノロジー(旧:日本電産リード)	2B-11
アズマ	6D-04	SHENGYI TECHNOLOGY	5i-05	日本アグファマテリアルズ	6F-14
アドテックエンジニアリング	2C-07	四会富仕電子科技股份有限公司	6D-03	日本エパレット・チャールス	2B-15
アトテックジャパン	6B-11	四国化成工業	6G-15	日本電子回路工業会(JPCA)書籍販売コーナ	3H-10
アルメックステクノロジーズ	2G-16	澁谷工業	2D-10	日本ビューワークス	2B-13
イー・エス・アイ ジャパン	6B-11	標茶町	3H-04	日本ミクロン	6E-07
石井表記	3D-03	島根富士通 / 出雲市	6B-04	日本ミクロン	3i-06
石原ケミカル	6G-11	JADASON Enterprises Ltd.	6D-02	ハイロックス	2A-01
利送イーエムシー	2F-24	ジャプロ工業	6G-12	伯東	2C-05
イチカワテクノファブリクス	6F-09	JIANGXI JIANGNAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY	6E-02	PAN-TEC CORPORATION LIMITED	6D-02
伊原電子工業	5i-09	SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS	6F-02	ピアメカニクス	3B-30
イワキ	3E-02	Schmoll Maschinen GmbH	3E-07	PCBGOGO	6E-04
インコム	3B-24	松和産業	5i-06	日立ハイテクサイエンス	6E-05
インスペック	2B-07	ショーダテクトロン	3D-09	ファーマネス	2B-03
インターエクスソフト	2E-10	JOHNNAN	3i-05	和仁貿易	6D-02
ウシオ電機	2C-06	シライ電子工業	3E-06	フィッシャー・インストルメンツ	2B-05
HAA 光学	2A-09	シライ電子工業	3i-08	ブイ・テクノロジー	3F-01
HKPCA (香港線路板協会)	3B-28	展耀科技(香港)	2D-05	Forewin Flex	6G-08
エイト工業	6A-05	伸光製作所	6B-05	福井県工業技術センター / 福井大学	3i-02
エーティージールーサーアンドメルツァー	2B-15	新興電気	3B-30	福田金属箔粉工業	6A-03
NTW Inc.	6F-12	深圳市ニューセス実業	6G-16	FUJI	3i-11
FICT	6E-06	Shenzhen Jingxin Electronic Technology	3B-27	富士高分子工業	5i-04
LPKF Laser & Electronics	3D-06	SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY	6E-16	フジブリグループ	2E-11
オーク製作所	2C-04	Shenzhen Mason Electronics	2B-15	藤森工業	6A-01
オーツカ光学	2A-09	SCREEN PEソリューションズ	2E-17	仏山市承安集団股份有限公司	6G-06
大船企業日本	2B-04	珠海市復興支援ブース	3A-14	プラズマイオンアシスト	3i-10
オカダジーエージェイ	3E-01	ステラ	3B-30	ブラメックス	6D-06
オカダジーエージェイ	6D-02	ステラ・コーポレーション	2A-04	プリント回路ジャーナル	2G-11
奥野製薬工業	3i-07	嵩台資訊股份有限公司	3B-29	ブルックスジャパン	3C-05
オンテック	2F-23	台強電機	2E-13	ベアック	3E-05
科学情報出版	3B-23	大成ラミネーター	3A-10	マイクロクラフト	3D-01
鹿児島県	3B-22	ダイセル	5G-03	マコー	3E-04
華正新材料	6E-03	ダイナトロン	2D-11/2E-16	マックエイト	6A-05
金井重要工業	6F-13	大日光・エンジニアリング	5i-08	丸源鐵工所	3B-29
カネカ	6C-01	太陽インキ製造	6B-03	ミカドテクノス	2D-09
兼松	2E-14	太陽インキ製造	3i-09	ミクロ技術研究所	6F-15
いすゞ製作所	2A-14	太洋工業	2B-12	三菱ガス化学	6A-04
日刊工業新聞社	2G-13	ダイワ	2B-16	三菱電機	2C-08
広東駿亜電子科技股份有限公司	6C-03	ダイワ工業	6A-07	南知床・ヒグマ情報センター / 標茶町	3H-04
北川精機	2C-01	タカノ	2G-15	ムラキ	3E-03
九州工業大学 マイクロ化総合技術センター	2E-12	タケウチ	2D-04	メイコー	6B-06
協栄プリント技研	6F-10	China Circuit Technology (Shantou)	6G-01	メック	6D-09
京写	6A-09	Jiangsu Provision Electronics	6F-07	メルテックス	6G-13
清川メック工業	2F-21	チュウリップ	2A-13	モトロニクス	3B-19
熊本県	3B-21	角田ブラシ製作所	6F-08	守谷商会	2A-14
クラブオウ	3A-21	ティーシーティー・ジャパン	6G-10	山形大学 YU-FIC	3B-20
ケイ・ピー・ディ	3i-12	TPCA (台湾電路板協会)	3A-17	ヤマハファインテック	2A-03
KFE Hong Kong	6C-04	TESTONIC	3D-07	ユニオン ツール	6D-02
KPIA (Korea Packaging Integration Association)	3A-13	テスプロ	2A-02	ヨクスル	2F-25
KPCA (韓国電子回路産業協会)	3A-19	TAESUNG	3A-11	利昌工業	6E-01
ケミックス	2B-14	デノラ・ベルメック	6F-06	RYODEN (旧:菱電商事)	6A-02
ケミロン	2E-15	デンカ	5H-05	レゾナック	6C-02
公安調査庁	3G-11	電気印刷研究所	3i-13	(旧昭和電工 / 昭和電工マテリアルズ)	6C-02
合成樹脂工業協会	2G-10	電子回路企業年金基金	2G-12	レヨン工業	2F-27
神戸大学工学研究科 電気電子工学専攻	3H-02	電子情報技術産業協会 (JEITA)	3G-06	ワンダーフューチャーコーポレーション	3i-14
塚本・寺田研究室	3H-02	電波新聞社	3A-15		
Goal Searchers CO., LTD., ZHUHAI	6D-01	東京マシン・アンド・ツール	6D-02	3D-MIDパビリオン	
相模ピーシーアイ	6A-08	東京マシン・アンド・ツール	3B-30	岩手県工業技術センター	3A-09
魁半導体	2D-07	東洋アルミニウム	5i-03	図研	2G-04
山栄化学	6G-14	中島化学産業	6B-01	大英エレクトロニクス	3A-08
		ニコン / ニコンソリューションズ	2A-10	太陽インキ製造	3A-07
		ニソール	5i-07	日本MID協会	2G-05
				ワンダーフューチャーコーポレーション	2G-06
				JPCA 半導体パッケージング	
				アズワン	6E-08

ADEKA	6B-10
池上精機	6E-13
AJ	6E-12
エクシール	6D-08
奥野製薬工業	6C-05
カールツァイス	6B-07
三喜製作所	6E-15
JSR	6E-14
シチズン電子	6A-13
シミズ	6E-09
世紀精密	6E-10
TOWATEC	6D-07
内藤電誠工業	6A-12
長瀬産業	6B-09
日本電気硝子	6A-14
日本バーンズ	6D-05
フォアサイト	6E-11
フジ機工	6B-08

JPCAフレキシブルプリント配線板製品

圓裕企業	5i-02
沖電線	5H-04
GIGAVIS	5F-02
Korea Electronics Technology Institute	5H-02
シーマ電子	5G-01
寧波聚嘉新材料科技 (JUJIA)	5H-03
八光電子工業	5F-01
明和産業	5H-03
山下マテリアル	5H-01
ワンダーフューチャーコーポレーション	5i-01

JPCA 機器・半導体受託生産システム展

ODTECH	6G-04
富士電子	6F-05
ブライムテックエンジニアリング横浜工場	6G-02
Luci	6F-04
和光電研	6F-03

2023 マイクロエレクトロニクスショー

Addison Clear Wave Coating	2E-03
EME	2D-02
エレクトロニクス実装学会 (JIEP)	2E-02
日機装	2D-03

eX-tech

秋田化学工業	2H-01
アテネ	2H-08
アドバンスマテリアルズテクノロジー	2H-09
アンドールシステムサポート	2H-26
エスベック	2H-23
大阪有機化学工業	2H-07
クツザワ	2H-14
JNC	2H-19
JNC 石油化学	2H-19
Shimada Appli	2H-02
新菱	2H-28
セトラスホールディングス	2H-29
ティール・エイ・インストルメント・ジャパン	2H-15
TEGソリューション	2H-25
電気印刷研究所	2H-17
東芝ビジネスエキスパート	2H-22
日邦産業	2H-16
日本スベリア社	2H-12
ノードソン	2H-04
ハニー化成	2H-30
ビーエムティー	2H-18
日立パワーソリューションズ	2H-21
藤倉化成	2H-13
プラスマイオンアシスト	2H-20
メルコセミコンダクタエンジニアリング	2H-10

アカデミックプラザ

岩手大学 理工学部	3A-06
-----------	-------

エクストコム	3C-01
愛媛大学 大学院理工学研究科	3B-14
大阪公立大学 大学院工学研究科	3A-04
沖エンジニアリング	3A-02
神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部 電子デバイスグループ	3B-05
カナルウォーター	3B-04
関東学院大学大学院工学研究科 物質生命科学専攻	3A-01
関東学院大学大学院工学研究科 物質生命科学専攻	3A-02
関東学院大学大学院工学研究科 物質生命科学専攻	3A-03
九州大学 大学院システム情報科学研究院	3A-05
九州大学 工学研究院機械工学部門 先端医療デバイス研究室	3C-01
グリーンケム	3A-04
群馬大学大学院 理工学府 井上研究室	3B-16
公立諏訪東京理科大学 機械電気工学科	3B-04

公立諏訪東京理科大学 地域連携開発機構

医療介護・健康工学部門	3B-04
-------------	-------

独立行政法人国立高等専門学校機構

長野工業高等専門学校 中山研究室	3B-08
------------------	-------

独立行政法人国立高等専門学校機構

長野工業高等専門学校 カ丸研究室	3B-08
------------------	-------

山陽小野田市立山口東京理科大学

工学部機械工学科	3B-01
----------	-------

シチズンファインデバイス

信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室	3B-07
---	-------

信州大学スピンドバイステクノロジーセンター

電磁材料研究所 研究開発事業部 次世代高次機能デバイス開発部門	3B-11
------------------------------------	-------

東海大学 土屋秀和研究室

東京工芸大学 越地研究室	3B-06
--------------	-------

東京理科大学 創域理工学部 電気電子情報工学科 山本研究室

東京理科大学 総合研究院 スマートヘルスケアシステム研究部門	3B-03
-----------------------------------	-------

**東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻
日暮研究室**

徳島大学 大学院社会産業理工学研究部	3B-15
--------------------	-------

日本カニゼン

日本大学 理工学部 精密機械工学科	3B-09
-------------------	-------

日本大学 理工学部精密機械工学科

齊藤研究室	3B-10
-------	-------

JISSO PROTEC 2023

アユミ工業	4B-09
アルファエレクトロニクス	4B-04
EGS	4B-02
池上精機	4A-04
イチネン製作所	4C-01
ウイングビジョン	4B-10
エイテックテクトロン	4A-07
奥田貿易	4B-07
奥原電気	4B-05
オムロン	4C-06
化研テック	4B-11
川崎重工業	4D-01
Gichoビジネスコミュニケーションズ	4B-01
サヤカ	4C-07
CKD	4D-02
JFE 商事エレクトロニクス	4A-05
JUKI	4D-05
ジュッツジャパン	4B-14
昭立電気工業	4B-12
太洋電機産業	4C-03
タムラ製作所	5F-06
テクノアルファ	4A-10
東洋リビング	4B-08
日本トムソン	4D-03

日本スベリア社	4A-11
日本ミルテック	4D-04
日本ロボット工業会 (JARA)	4A-01
バーミジャパン	4B-15
ハイウイン	4A-09
バスコン	4C-02
白光	4A-13
パナソニック コネクト	5B-21
ファナック	4C-04
FUJI	5F-07
ブルックス・ジャパン	4A-03
プロセス・ラボ・ミクロン	4A-08
ヘラーインダストリーズ・インク	4A-12
ベントロン	4A-06
ボゾンジャパン	4C-05
マルコム	4B-06
武蔵エンジニアリング	4C-08
ヤマハ発動機	4A-14
ルックス電子	4B-13

SDGsデバイス展

アンピクス	2G-01
産業タイムズ社	2G-03

WIRE Japan Show 2023

工業通信	3D-10
タツタ電線	3D-04

Electronics Component & Unit Show

アール電子	5H-12
飯田通商	6A-10
NNP	6A-17
岡本無線電機	5G-07
グローバルディスプレイ	5H-06
コアスタッフ	5H-10
三共社	5F-04
成電社	5H-08
摂津金属工業	5H-07
全国電子部品流通連合会 (JEP)	5G-04
大和無線電機	5H-11
ツルタ制御機器	5i-10
東亜無線電機	5G-05
東京都電機卸商業協同組合 (TEP)	5G-04
富永電気	5i-11
鳥居電業	5G-06
名古屋理研電具	6A-11
日川電機	5H-13
ト口電気	5F-05

E-Textile/Wearable

アイトス	3F-06
いしかわ次世代スマートテキスタイル研究会	3F-02
ウラセ	3G-08
ザクティ	3F-04
サンコロナ小田	3F-05
ジャパンメディアシステム	3G-10
JOHNNAN	3G-03
織研新聞社	3G-05
大喜	3F-03
東京大学 伊藤・高松研究室	3G-09
米澤物産	3G-12

Smart Sensing 2023

アール・ティール・シー	5D-01
アイ・アール・システム	5B-14
IDTechEx	5B-12
朝日ラバー	5E-03-5
アルプスアルパイン	5E-03-8
イーエクスプレス	5C-05
YITO A マイクロテクノロジー	5D-03

イノベーションリサーチ	5B-17
impactTV	5E-03-10
AEMtec GmbH	5D-04
SMK	5C-15
NTTアドバンステクノロジー	5B-28
エネルギーハーベスティングコンソーシアム	5V-10
ガゾウ	5B-16
金沢大学振動発電研究室	5V-02
金沢大学 V-COLLABO	5V-04
ナノシード	5B-20
クローネ	5C-11
グローバルインフォメーション	5C-02
ケイエルビイ	5B-27
神戸デジタル・ラボ	5E-03-2
コーデンシ	5B-13
コーンズ テクノロジー	5C-08
コネクテックジャパン	5D-04
産業技術総合研究所	4G-16
ジャパンディスポレイ	5E-01
住友金属鉱山 技術本部 技術企画部	5V-05
センシリオン	5B-22
ソフトエイジェンシー	5B-18
泰興物産	5E-03-4
タッチエンス	5C-04
椿本興業	5F-08
帝国インキ製造	5C-14
ディジインターナショナル	5C-12
デルタツーリング	5E-03-7
東海理化電機製作所	5B-26
東京応化工業	5D-05
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	5B-29
内藤電誠町田製作所	5C-17
ナルコム	5B-23
南陽	5E-03-13
日清紡マイクロデバイス	5B-11
日本ガイシ	5V-12
韓国国立ナノファブセンター	5C-10
福田結晶技術研究所	5V-01
富士通コンポーネント 無線ネットワーク	5E-03-11
富士通コンポーネント センサーセクション	5C-09
フジトク	5B-19
ボールウェーブ	5C-07
ポリテックジャパン	5F-09
ホルトプラン	5C-06
マイクロモジュールテクノロジー	5C-13
マクセル	5E-03-6
マクニカ アルティマカンパニー	5E-03-12
マルティスーブ	5E-03-3
ミオ・コーポレーション	5B-24
MODE, Inc.	5E-03-1
ものづくりドットコム	5C-03
ヤシマ電気	5V-06
横山商会	5V-07
リコー	5E-03-9
リンテック	5V-11
ロボティック普及促進センター	5D-02

無人化ソリューション展

アキュイティ	5E-02
アベルザ	5E-02
伊藤光学工業	5E-02
宇部情報システム	5E-02
NDIソリューションズ	5E-02
岡崎製作所	5E-02
コグネックス	5E-02
スカイディスク	5E-02
東洋電装	5E-02
ドリーム・アーツ	5E-02
日伝	5C-16

ネクステッジテクノロジー	5E-02
バルーフ	5E-02
プレティア・テクノロジーズ	5D-06
メルク	5E-02
Rochester Electronics	5E-02

Edge Computing

アストロン	4F-17
アットマークテクノ	4F-19
Izuma Networks	4G-13
ダイナコムウェア	4G-11




InterOpto




アイ・アール・システム	5B-15
アイオーコア	4F-09
アドコム・メディア	5A-03
アドバンテス	5B-05
阿南工業高等専門学校	5A-10
アルネアラボラトリ	5A-07
イー・アンド・イーエボリューション	5B-10
エイム	5A-02
The international society for optics and photonics (SPIE)	4E-08
オプトゲート	5A-01
オプトロニクス社	4G-06
オレンジアーチ	4E-03
韓国光産業振興会	4F-14
京都光技術研究会	4F-02
グラビトン	4G-05
公立千歳科学技術大学	5A-05
湖北工業	5A-13
ジューニアライト	4G-02
ジェー・イー・ウーラム・ジャパン	5A-16
シナジーオプトシステムズ	4G-09
芝原工業	4F-06
島津製作所	5A-15
SHANGHAI KENRYU TRADING	4H-01
Stella	4F-08
SteraVision	4G-03
スペースフォトン	5A-14
スペクトルデザイン	5B-06
住友電気工業	5A-06
大興製作所	4F-04
ZHEJIANG LANTE OPTICS	4H-01
千歳市/公立大学法人 公立千歳科学技術大学	5A-05
Zhongshan Sichuang Optoelectronics Technology	4E-06
テクノハンズ	5A-17
テラヘルツテクノロジーフォーラム	5A-08
東海エンジニアリングサービス	4F-02
東莞市五豊電子	4F-12
徳島大学ポストLEDフォトリクス研究所	5A-11
長岡技術科学大学	5A-09
日東光器	4F-03
バイフォトリクス	4E-02
光科学技術研究振興財団	4G-07
光産業技術振興協会 (OITDA)	4G-04
光産業創成大学院大学	5A-12
技術研究組合光電子融合基盤技術研究所	4F-10
フォトテクニカ	4E-04
フォトニック・エッジ	5B-08
フォトニックサイエンステクノロジー	5B-09
堀場製作所	4F-07
マイクロシグナル	4F-05
丸文	4E-05
ミックテック	4F-14
UBE	4F-11
理化学研究所	5B-07
レーザー輸入振興協会	5A-04
レーザー協会	4G-08
Laser Focus World Japan	4F-01




ロゼッタ	4G-01
Imaging Japan	
ヴィ・エス・テクノロジー	4E-09
エバ・ジャパン	4E-01
Caeleste CVBA	5B-02
サイバネットシステム	4F-15
太平貿易	4F-13
日進機械	5A-18
マイクロン	5B-01
三ツ波	4E-07

電子機器トータルソリューション展 基調講演(JPCA創立60周年記念) 有料 VIP/会員無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会場：セミナー会場A ●聴講者数：全9セッション 1,544名

5月31日(水)	10:45 11:30	 メタバースとSDGsで高成長を狙う!～ニッポン及び世界の半導体の大型プロジェクトに注目～ 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社 代表取締役会長
	11:45 12:30	 半導体・デジタル産業戦略の現状と今後 萩野 洋平 経済産業省 商務情報政策局 デバイス・半導体戦略室 室長
	13:30 14:15	 脱炭素社会の実現に向け、ますます重要となるパワー半導体とアナログ技術 松本 功 ローム(株) 代表取締役社長 社長執行役員 CEO

6月1日(木)	10:45 11:30	 すべての人に移動の自由を -トヨタの自動運転技術開発の取組み- 鯉淵 健 トヨタ自動車(株) コネクティッドカンパニー ビジネス領域 統括部長/フェロー
	11:45 12:30	 製造業が直面する労働力問題と電子業界への自動化の提案 ～製造現場に導入しやすい自動化を目指して～ 山口 賢治 ファナック(株) 代表取締役社長 兼 CEO / (一社)日本ロボット工業会 会長
	13:30 14:15	 変える力とつなぐ力でIoT実装に革命を 平田 勝則 コネクテックジャパン(株) 代表取締役社長

6月2日(金)	10:45 11:30	 半導体、半導体製造装置 その未来と課題 寺本 章伸 広島大学 ナノデバイス研究所 所長・教授
	11:45 12:30	 日本の半導体戦略 ～More Moore, More than Moore, More People～ 黒田 忠広 東京大学 大学院工学系研究科附属 システムデザイン研究センター 教授
	13:30 14:15	 ウェアラブルデバイスが切り拓く人間とコンピュータの新たな関係 ～医療・健康・教育・エンタテインメント～ 寺田 努 神戸大学 大学院工学研究科 教授

JPCA創立60周年記念特別講演 プログラム 無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会場：セミナー会場A ●聴講者数：全3セッション 755名

5月31日(水)		 エレクトロニクス産業とイノベーションの波 日本は捨てたもんじゃない 片山 幹雄 東京大学 生産技術研究所 研究顧問 / (株)Kconcept 代表取締役社長 (元シャープ社長)
6月1日(木)	14:30 15:30	 空飛ぶクルマ時代のビジネスについて 浅井 尚 エアモビリティ(株) 代表取締役社長&CEO
6月2日(金)		 新たな世界的半導体イノベーション時代の幕開け 小池 淳義 Rapidus(株) 代表取締役社長



JIEP最先端実装技術シンポジウム 有料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会場：会議棟6階 605+606会議室(A会場) および 607+608会議室(B会場) ●聴講者数：2,294名




A会場		B会場	
	31A-1 高度化するMEMS,センサーデバイス技術最前線 座長：土門 孝彰、西田 秀行		31B-1 5G/6G高周波材料 座長：松本 博文、高野 希
9:45-10:40	31A1-1 ロボットが繊細作業を行うための小型力覚センサ～MEMS+金属構造体のハイブリッド実装～ 井上 匡志 MMIセミコンダクター(株) MEMS開発部 技術専門職		31B1-1 5G/6Gに向けた高速・高周波用途向け基板材料の技術開発動向 広川 祐樹 パナソニック インダストリー(株) 電子材料事業部 電子基材 BU 商品開発部 開発一課 課長
10:40-11:35	31A1-2 自動運転に向けたLIDAR技術の基礎と最新開発状況 高橋 昌幸 ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 車載事業部・車載設計部 統括部長		31B1-2 5G/6Gを見据えた高周波対応材料の技術・開発動向 森野 正行 AGC(株) 化学品カンパニー 企画部 材料開発室 室長
11:35-12:30	31A1-3 住友精密工業のMEMS事業について～高度500kmから地下4000mまで精密に測定する～ 田中 洋 住友精密工業(株) MEMS事業室 事業室長		31B1-3 低伝送損失基板を実現する低誘電・高接着ポリイミド樹脂「PIAD」 山口 貴史 荒川化学工業(株) 研究開発本部 ファイン・エレクトロニクス開発部 PIグループ 主査
	31A-2 自動運転システムとセンシングの最新動向 座長：三宅 敏広、齊藤 雅之		31B-2 メタバース時代への半導体進化 座長：西田 秀行、土門 孝彰
13:35-14:30	31A2-1 ステレオカメラの認識技術とその応用 渡邊 龍人 (株)ZMP ロボテック開発部 チーフエンジニア		31B2-1 IOWN構想を支える光電融合実装技術 石井 雄三 日本電信電話(株) NTTデバイスイノベーションセンター プロジェクトマネージャー
14:30-15:25	31A2-2 自動運転を構成する技術 クライソントロンナムチャイ 神奈川県立大学 創造型工学部 自動車システム開発工学科 教授		31B2-2 「メタバースの時代」は来るのか～企業にとってのメタバースの真の価値とは～ 倉島 菜々美 日本アイ・ビー・エム(株) IBMコンサルティング事業本部 インタラクティブ・エクスペリエンス事業部 技術理事 インタラクティブ・エクスペリエンス事業部 CTO
15:25-16:20	31A2-3 自動運転のためのLiDAR技術 伊東 敏夫 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科 教授		31B2-3 2023～24年の電子機器と半導体市場展望 南川 明 インフォマインテリジェンス(合) コンサルティング シニアコンサルティングディレクター

	01A-1 光電回路技術と半導体の役割 座長：高武 直弘、谷 元昭		01B-1 情報爆発の救世主、真の省エネを具現化するパワー半導体！ 座長：土門 孝彰、渡邊 裕彦
9:45-10:40	01A1-1 クラウドデータセンター光ネットワークの動向と展開 高井 厚志 LitAhead Consultant 光技術コンサルタント		01B1-1 低炭素社会に貢献できる パワーデバイス・モジュール技術 多留谷 政良 三菱電機(株) パワーデバイス製作所 主管技師長
10:40-11:35	01A1-2 シリコンフォトニクスを用いた光電コパッケージ用パッケージ基板の研究開発 中村 文 (国研)産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター 研究員		01B1-2 次世代パワー半導体が貢献する「カーボンニュートラル」 吉持 賢一 ローム(株) LSI事業本部 パワーステージ商品開発部 統括課長
11:35-12:30	01A1-3 光回路と「光を用いて計算する」コンピューティング技術 橋本 俊和 日本電信電話(株) NTT先端集積デバイス研究所 上席特別研究員		01B1-3 GaO [®] パワーデバイス&独自パワーモジュールの社会実装を実現するグローバル・オンリーワン企業 井川 拓人 (株)FLOSFIA 営業部 エヴァンジェリスト 共同創業者
	01A-2 自動車の電動化・パワーエレクトロニクスの動向と実装技術 座長：三宅 敏広、齊藤 雅之		01B-2 「半導体の進化を支える、日本の基板技術」ー HPC対応半導体/3D-IC/Chip-letに求められる配線基板とは、...ー 座長：西田 秀行、猪川 幸司
13:35-14:30	01A2-1 自動車の脱炭素化/EV化の最新動向と関連製品(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジー 代表		01B2-1 先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 規貴 新光電気工業(株) 開発統括部 主席部長
14:30-15:25	01A2-2 自動車用パワーエレクトロニクスの最新動向 森本 雅之 モリモトラボ 代表		01B2-2 先端パッケージ・サブストレートを支えるコア基材の最新動向 尾瀬 昌久 (株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター 積層材料開発部 部長
15:25-16:20	01A2-3 車載用パワー半導体モジュールのパッケージ技術 池田 良成 富士電機(株) 半導体事業本部 開発統括部 パッケージ開発部 先行開発課 課長		01B2-3 半導体基板(FCBGA)の需要供給状況と今後の見通し 亀和田 忠司 AZ Supply Chain Solutions ビジネスコンサルティング オーナー

	02A-1 AR/VR AI(仮想空間にリアルの世界を作り出す日本の底力)を牽引する実装技術 座長：土門 孝彰、池田 浩昭		02B-1 「日の丸半導体復活、実現の鍵は...?」ー Rapidus/LSTC, IBM, i-Mecが描くシナリオー 座長：西田 秀行、和嶋 元世
9:45-10:40	02A1-1 先端実装の装置技術 奥園 博和 東レエンジニアリング(株) メタロファインテック事業本部 第一事業部 営業部 部長		02B1-1 再び挑む、最先端半導体パッケージ開発の舞台 榎本 貴男 Rapidus(株) 3Dパッケージ部 ディレクター
10:40-11:35	02A1-2 マイクロエレクトロニクス実装材 最新技術動向 大関 裕樹 デクセリアルズ(株) コネクティングマテリアル事業部 商品開発部 統括課長		02B1-2 LSTCの先端半導体3Dパッケージングへの挑戦 菅沼 克昭 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 所長・特任教授
11:35-12:30	02A1-3 半導体設備のAR/VR、AIの採用動向 横森 憲敬 東京エレクトロ(株) Corporate Innovation本部 副本部長 東京エレクトロ宮城(株) 執行役員 先端技術開発本部 DX推進担当		02B1-3 ニッポン半導体の再生における実装技術の重要性、最後に最大の機会を活かせ 若林 秀樹 東京理科大学大学院 経営学研究科 技術経営専攻(MOT) 教授
	02A-2 ロードマップセッション 座長：本多 進、猪川 幸司		02B-2 「Moore則継続への挑戦、3D-IC/Chipletの現状とこれから」ー 前工程と後工程の融合、3DIC Monolithicの実現は、...ー 座長：高野 希、谷 元昭
13:35-14:30	02A2-1 電子デバイス実装技術のロードマップ ・第一部：CPS(Cyber-Physical System)の進展に向けて多様化が加速する電子デバイスパッケージ ・第二部：実装技術の未踏領域への挑戦(バイオセンサー) 杉崎 吉昭 (株)東芝 研究開発センター 先端デバイス研究所 バックエンドデバイス技術ラボラトリー		02B2-1 レゾナックの次世代半導体パッケージに向けた取り組みとJOINT2進捗 島山 恵一 (株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューションセンター センター長
14:30-15:25	02A2-2 JEITA・電子部品技術ロードマップーチップ部品、センサー部品を中心にー 梶田 栄 NPO法人サーキットネットワーク 理事長		02B2-2 AI/ML時代を切り拓くウェーハ接合技術 山本 宏 イーヴィグループジャパン(株) 代表取締役
15:25-16:20	02A2-3 100 Tb/s超スループットの実現に向けた光回路実装形態の予測と課題 竹崎 元人 (株)白山 経営管理本部 IOWN推進部 部長		02B2-3 パネルレベルファンアウトFOLP [®] ならびにチップレット集積化Die-to-Die Pillar-Suspended Bridge(PSB)技術について 河野 一郎 アオイ電子(株) FOLP事業部 FOLP/AA課 課長

JISSO PROTEC特別講演 無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会場：セミナー会場H ●聴講者数：511名

5月31日(水)			スマートフォン・周辺機器業界見通し 中根 康夫 みずほ証券(株) エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト
6月1日(木)	10:30-11:20		JEITA2022年度版実装技術ロードマップ「注目される市場と電子機器群」 ～ 脱コロナ・脱炭素を加速する新市場 ～ 西村 隆 JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会 委員長/三菱電機(株) 先端総合研究所 パワーモジュール技術部 主席研究員
6月2日(金)			EV時代に対応する接合材料・実装技術 神谷 有弘 (株)デンソー 半導体基盤技術開発部

Electronics Component & Unit Show特別講演 無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会場：セミナー会場L ●聴講者数：113名

5月31日(水)			眼鏡フレーム技術を活かしたARグラスの産官学共同開発事例の紹介 芦原 将彰 福井県工業技術センター 機械・金属部 デジタル技術研究G 主任研究員
6月1日(木)	15:45-16:30		光導波路型合波器を用いたレーザー走査型映像投影装置の超小型化 中尾 慧 福井大学 産学官連携本部 特命助教
6月2日(金)			エレクトロニクスの用途拡大 ～スポーツ分野への応用～ 塚本 淳二 CBC(株) New Business Department スポーツビジネスユニット プロジェクト・マネージャー

OITDAセミナー「産業の高度化・微細化に貢献する光・レーザ技術」

●日 時：5月31日(水) ●会場：会議棟1階102会議室 ●聴講者数：210名

5月31日(水)	10:25-10:30	主催者挨拶 小谷 泰久 (一財)光産業技術振興協会 副理事長兼専務理事
	10:30-11:10	レーザー微細加工におけるTACMIコンソーシアムの取り組み 小林 洋平 東京大学 物性研究所附属極限コヒーレント光科学研究センター 教授
	11:10-11:50	プリント基板 レーザ加工の現状と未来 金田 充弘 三菱電機(株) 産業メカトロニクス製作所 レーザ製造部 マイクロ加工機設計課 課長
	11:50-12:30	スマートグラス開発の現状と今後の展開 高木 将行 セイコーエプソン(株) VSMプロジェクト シニアスタッフ
	14:00-14:40	マイクロ・ナノフォトニクスの可能性を探る 欧州のエコシステム カルロス・リー European Photonics Industry Consortium (EPIC (EU)) Director General
	14:40-15:20	AR/VR・自動車産業におけるイメージングとセンシングのトレンド ホセ・ポソ OPTICA (USA) CTO

1) 出展者 (NPI) プレゼンテーション

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場 G / セミナー会場 M ●聴講者数：1,180名

●発表出展会社

(50音順)

アンドールシステムサポート(株) / (株)石井表記 / Izuma Networks / (株)イワキ / ウシオ電機(株) / LPKF Laser & Electronics(株) / 圓裕企業(株) / (株)オーク製作所 / 沖電線(株) / 奥野製薬工業(株) / (株)オンテック / 金井重要工業(株) / (株)ケミトックス / (株)魁半導体 / (株)三共社 / 澁谷工業(株) / Shimada Appli 合同会社 / (株)図研 / (株)ソフトエイジェンシー / ダイナトロン(株) / ティー・エイ・インストルメント・ジャパン(株) / テクノアルファ(株) / 東亜無線電機(株) / 東洋アルミニウム(株) / 日機装(株) / 日邦産業(株) / 寧波聚嘉新材料科技 (JUJIA) 有限公司 / ノードソン(株) / ファナック(株) / (株)ブイ・テクノロジー / フォトテクニカ(株) / (株)プラズマイオンアシスト / プラメックス(株) / (株)ブルックスジャパン / (株)堀場製作所 / 三菱ガス化学(株) / メルテックス(株) / ユニオン ツール(株) / (株)ワンダーフューチャーコーポレーション / (株)日立ハイテクサイエンス

2) 第19回 JPCA 賞 (アワード) 受賞者

この度、JPCA賞(アワード)選考委員会にて、厳正なる審査の上、第19回JPCA賞(アワード)受賞企業が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。JPCA賞(アワード)は、参加企業の中から、応募のあった発表内容の『独創性(独自性・オリジナリティ)』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時世の適合性』を審査基準として、学术界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々が構成するJPCA賞(アワード)選考委員会によって厳正な審議を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として2005年より実施しています。

【表彰式】セミナー会場 B 日時：5/31(水) 16:40～16:55

JPCA賞	
■アドバンスト・パッケージ基板向け次世代露光機「UX-58112SC」	ウシオ電機(株)
■大口径ビア / 高速伝送用途 / 次世代 FOWLP および FOPLP 向け 半導体パッケージ基板用 硫酸銅めっき添加剤	奥野製薬工業(株)
■高密度性を発現する界面分子結合材「MOLTIGHT IMB」	JSR(株)
■次世代半導体パッケージの再配線層(RDL)に適した新しい感光性絶縁フィルム	太陽インキ製造(株)
■次世代高誘電率 BTレジン積層板材料「HL920 / GHPL-920シリーズ」	三菱ガス化学(株)
■銅炭素複合材料による次世代オプトエレクトロニクスデバイスの放熱設計の展開	UBE(株)

JPCA 奨励賞	
■プラズマ処理による表面改質特性の長期保持技術	魁半導体(株)
■エレクトロニクスを融合した基板設計CADのEMC検証ツール“業界初”「3D EMC Adviser」の開発	(株)図研



3) 3D-MIDパビリオンセミナー

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場 E ●聴講者数：151名

●発表出展会社：(地独) 岩手県工業技術センター / (株)図研 / (一社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) / 日本MID協会 / (株)ワンダーフューチャーコーポレーション

(50音順)

4) PROTECセミナー

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場 I ●聴講者数：677名

●発表出展会社：オムロン(株) / JUKI(株) / パナソニック コネクト(株) / (株)FUJI / 武蔵エンジニアリング(株) / ヤマハ発動機(株)

(50音順)



出展者セミナー 無料

5) アカデミックプラザ

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場E ●聴講者数：522名

●発表出展大学・研究機関等一覧

(50音順)

大阪公立大学 / 関東学院大学大学院工学研究科 / 関東学院大学大学院工学研究科・日本カニゼン(株) / 関東学院大学大学院工学研究科・フォテクノカ(株) / 群馬大学大学院 理工学府 / 山陽小野田市立山口東京理科大学 / 信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室 / 諏訪東京理科大学 地域連携開発機構 医療介護・健康工学部門・(株)フジタ / 東京工芸大学 / 東京工芸大学大学院 / 東京理科大学 / 同志社大学大学院 / 東北大学 / 徳島大学大学院 / 長野工業高等専門学校 / 日本大学大学院理工学研究科 / 日本大学 マイクロデザイン研究室 / 北海道大学 工学研究院 / 山形県工業技術センター・東北大学大学院工学研究科

6) 2023 アカデミックプラザ受賞者

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示会委員会(越地委員長：東京工芸大学 工学部 電気電子コース 大学院工学研究科 電子情報工学専攻)で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定致しました。

【表彰式】セミナー会場E 日時：5/31(水) 16:40～17:00

■ IoTデバイスの継続的な発電に向けた小型有機ランキンサイクル発電システムの開発	日本大学 マイクロデザイン研究室
■ 非歩行下でも発汗量計測可能なヘルメット型デバイスの開発	公立諏訪東京理科大学 地域連携開発機構 医療介護・健康工学部門、カナルウォーター(株)フジタ 技術センター 生産改革研究部 先端システムグループ、(株)高環エンジニアリング 公立諏訪東京理科大学 地域連携開発機構 医療介護・健康工学部門、機械電気工学科
■ 歩行と走行を切り替える2足歩行制御用ハードウェアCPGモデルアナログICチップの検討	日本大学 マイクロデザイン研究室、日本大学 ニューロボティクス研究室
■ ロータス金属が引き起こすブリージング現象を利用した空冷および沸騰浸漬冷却技術	山陽小野田市立山口東京理科大学 (株)ロータス・サーマル・ソリューション
アカデミックプラザ10年連続継続賞	群馬大学 井上研究室 / 長野工業高等専門学校 中山研究室

7) Electronics Component & Unit Show 出展者セミナー

●日 時：6月2日(金) ●会 場：セミナー会場L ●聴講者数：18名

●発表出展会社：東亜無線電機(株)



Smart Sensing / 無人化ソリューション展 / Edge Computing セミナー

無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場K ●聴講者数：1,104名

Keynote Speech

5月31日(水)	10:15-11:05	日本ではあまり語られない、CES2023にみる米国のテクノロジー戦略 青木 崇 (株)日本政策投資銀行 業務開発部所属 参事役 / 政策研究大学院大学 シニアフェロー 鈴木 和泉 (国研) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー
	14:40-15:30	世界のトレンドからみたメーカーのトレンドとコトへの転換 上野 聡志 MODE, Inc. VP of Business
6月1日(木)	10:15-11:05	スマートセンシングとインターバース 持丸 正明 (国研) 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長
	11:35-12:25	<ピッチステージ>社会実装に進む磁歪振動発電の製品開発と将来展望 北 翔太 金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教 (株)福田結晶技術研究所 (株)横山商会 住友金属鉱山(株)
6月2日(金)	11:35-12:00	構内物流の自動化で実現するオペレーションの効率改善 三村 健二 (株)マクニカ イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部 モビリティソリューション部 プロダクトセールス課 課長
	12:00-12:25	ライブデモで実演!! ヒト・モノの移動における無人化を見据えて ~モビリティデータ活用の取り組み~ 上原 拓 (株)マクニカ イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部 DXソリューション部 プロダクトマーケティング第1課

特別講演

5月31日(水) 6月1日(木)	11:35-12:25	製造現場のIoT/DX化を実現するEdgecross 大谷 治之 (一社) Edgecrossコンソーシアム 事務局長
	15:45-16:30	Animal DX 藤本 靖 南知床・ヒグマ情報センター 理事長

パネルディスカッション

6月2日(金)	10:15-11:05	においてセンサを追求してわかったこと、これから起きること。
		モデレーター 吉川 元起 (国研) 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 電気・電子機能分野 嗅覚センサグループ グループリーダー パネリスト 緒方 健治 I-PEX(株) 取締役 常務執行役員 技術開発統括部長 喜多 純一 (株)において科学研究所 代表 今村 岳 (株)Qception 代表取締役

プレゼンテーション

5月31日(水)	12:45-13:25	IoTデバイスの電源問題を解決! 自立型IoTの社会実装をEnerCeraで実現 田中 立 日本ガイシ(株) NV推進本部 ビジネススクリエーション グループマネージャー
	13:45-14:25	多品種変量時代の戦い方“半導体実装開発に付加価値あり” 安藤 守 コネクテックジャパン(株) 取締役 常務執行役員
	15:45-16:25	エッジヘビーセンシングによる価値創造 ~集積システムによるエッジセンシングの高度化とその活用~ 室山 真徳 博士(工学) 東北工業大学 工学部 電気電子工学科 教授 / 東北大学大学院工学研究科ロボティクス専攻 客員教授 / (株)レイセンス 共同創業者・取締役・最高技術責任者
6月1日(木)	12:45-13:25	マスマーケット向けサーマルセンサーのユースケース拡大 Daniel Jarvis Teledyne FLIR
	13:45-14:25	ディスプレイ技術を応用した新しいセンシング技術 仲島 義晴 (株)ジャパンディスプレイ 執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー
	14:45-15:25	セキュアな省電力/長期供給のArm搭載CPUボード/IoTゲートウェイ「Armadillo」 實吉 智裕 (株)アットマークテクノ 代表取締役
6月2日(金)	12:45-13:25	自社の取り組みに役立つ企業事例から見る製造業DX 大岡 明 (株)産業革新研究所 取締役
	13:45-14:25	IoT = ニューノーマル 江川 将峰 デザインインターナショナル(株)
	14:45-15:25	統合力と総合力による少量多品種の劇的な生産性向上:機械加工業界の先進自動化事例 木本 彰 ファステムズ(株) アジアセールス パートナーマネージャー
	15:45-16:25	日本のデュアルユースロボットの行方 防衛装備庁における研究開発の取り組み 小林 賢一 ロボティク普及促進センター 理事長 / (株)ロボットメディア 代表取締役 藤井 圭介 防衛装備庁 技術戦略部 技術戦略課長

主催者セミナー

●ダントツものづくりセミナー 無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場C ●聴講者数：297名

5月31日(水)	13:00-13:45	【特別講演1】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO
	13:45-14:30	【特別講演2】月曜日が楽しみな会社にしよう！～全体最適のマネジメント理論 TOCとは～ 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO
	14:35-15:35	コロナ2019禍のトヨタ式改善事例 一標準のないところにカイゼンはないー 濱松 史郎 トヨタ自動車OB カイゼンコンサルタントサービス 代表
6月1日(木)	15:40-16:25	JPCAものづくり大賞準大賞受賞 改善取り組み事例報告3件 2018年度 (株)愛工機器製作所コア加工事業部 2019年度 板橋精機(株)岩間工場 2020年度 FICT(株)製造本部
	13:00-14:00	【特別講演3】危機対応で進化するグローバルサプライチェーンとものづくり 新宅 純二郎 東京大学 大学院経済学研究科 教授 経済学博士
	14:05-15:05	品質経営の取り組み方(シックスシグマ品質) アイリス リュウ マイクロンメモリジャパン(株) カスタマークオリティエキスパートシニアマネージャー 工学博士
6月2日(金)	15:10-16:10	製造業DXを実現 GD.findi - 未来を予測し、最適解を導く、唯一のDX技術 - 大橋 輝雄 (株)レクサー・リサーチ GSCグループ グループリーダー
	16:15-17:00	JPCAものづくり大賞準大賞受賞 改善取り組み事例報告3件 2020年度 (株)アスコテック新潟工場 2021年度 (株)メイコー福島工場 2021年度 太陽インキ製造(株)北九州事業所/埼玉工場
	13:00-13:45	【特別講演4】トヨタ式現場管理 田中 正知 トヨタ自動車OB ものつくり大学 名誉教授 / J-コスト研究所 代表
6月2日(金)	13:45-14:30	【特別講演5】現場改善のJコスト理論による強化策(ROA) 田中 正知 トヨタ自動車OB ものつくり大学 名誉教授 / J-コスト研究所 代表
	14:35-15:35	【特別講演6】経営者に見える現場改善効果「現場改善会計(GKC)」 柘 紫乃 愛知工業大学 経営学部経営学科 教授 博士(経営情報科学)
	15:40-16:25	【総括基調講演】経営効果がわかる、トヨタ生産システム 山本 治彦 JPCAものづくりアカデミー 校長

●【JEITA】半導体パッケージングセミナー 無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：127名

5月31日(水)	10:30-11:15	JEITA半導体標準化専門委員会について 吉田 浩芳 スヴオトンテクノロジー(株)
	11:30-12:15	JEITAシステムソリューション技術委員会の紹介 佐藤 賢央 ローム(株) 回路技術開発部
6月1日(木)	11:00-12:00	次世代プリント配線板製造を見据えたフッ素系樹脂への直接接着・めっき技術 小林 靖之 (地独)大阪産業技術研究所森之宮センター 電子材料研究部 総括研究員 表面工学研究室長
6月2日(金)	10:30-11:15	電子機器熱設計に効果的なプリント基板と半導体のモデリング技術 篠田 卓也 (株)デンソー エレクトロ技術3部
	11:30-12:15	熱解析を使いこなすために知っておきたいモデル化ノウハウと最新トレンド 武井 春樹 シーメンス(株)
	13:30-14:15	高密度配線パッケージの異物不良対策 ～サブミクロン異物の除去技術～ 篠原 友美 (株)ブルックスジャパン 代表取締役
	14:30-15:15	Wafer-Level Packagingでのガラス素材の可能性 上舘 寛之 LPKF Laser & Electronics(株) セールスディレクター

主催者セミナー

●経済安全保障セミナー 無料

●日 時：6月1日(金) ●会 場：セミナー会場D ●聴講者数：70名

1日(金)	13:00-14:30	経済安全保障の確保に向けて～技術・データ・製品等の流出防止～	原塚 勝洋 公安調査庁 調査第二部第一課 国際調査企画官
-------	-------------	--------------------------------	------------------------------

●ぷりんとはんじゅくセミナー 無料

●日 時：5月31日(水)・6月2日(金) ●会 場：セミナー会場F ●聴講者数：385名

5月31日(水)	11:00-12:00	プリント配線板全般の基礎“ぷりんとはんじゅくI”をもとに解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
	13:00-14:00	プリント配線板設計の基礎“ぷりんとはんじゅくII”をもとに解説	田中 弘文
	14:30-15:30	フレキシブル配線板の基礎“ぷりんとはんじゅくVII”をもとに解説	宮崎 博明 元MFインフォメーション(株) 代表
6月2日(金)	11:00-12:00	実装の基礎“ぷりんとはんじゅくV”をもとに解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
	13:00-14:00	品質管理の基礎	安井 博文 安井事務所 PWBコンサルタント

●JPCAプリント配線板技術ロードマップセミナー 有料

●日 時：5月31日(水)・6月1日(木) ●会 場：会議棟7階 701+702会議室 ●聴講者数：374名

5月31日(水)	13:00-14:00	2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論	宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株)
	14:00-15:00	高速通信システム	西尾 俊彦 (株)SBRテクノロジー
	15:00-16:00	高速通信機器用プリント基板	飯長 裕 OKIサーキットテクノロジー(株)
	16:00-17:00	多層プリント配線板ロードマップ	戸田 光昭 (株)メイコー
6月1日(木)	13:00-14:00	半導体市場動向	山本 義継 みずほ証券(株)
	14:00-15:00	半導体パッケージ技術動向	宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株)
	15:00-16:00	機能集積配線板技術動向	吉村 英明 FICT(株)
	16:00-17:00	半導体パッケージ用サブストレート	加藤 功 凸版印刷(株)

●製品安全セミナー 無料

●日 時：6月1日(木) ●会 場：セミナー会場F ●聴講者数：22名

1日(木)	13:30-14:30	プリント配線板の製品安全セミナー	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
-------	-------------	------------------	------------------------

●熱関連セミナー 無料

●日 時：6月1日(木) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：85名

6月1日(木)	13:30-14:30	JPCA熱関連セミナー	鈴木 康一 山口東京理科大学 名誉教授/畠山 友行 富山県立大学 准教授
	14:30-15:30	「高放熱ヒートスプレッド、ダイヤモンドフィラー分散銅鍍金被膜」について	別所 毅 トヨタ自動車(株) モビリティ材料技術部 車両材料開発室 プロフェッショナル・パートナー

●車載電子機器向け電子回路基板規格書ガイドラインセミナー 無料

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場C ●聴講者数：63名

5月31日(水)・6月1日(木)	10:30-11:15	車載電子機器向け電子回路基板規格書ガイドラインセミナー	浦西 泰弘 JPCA高信頼性車載用電子回路評価基準WG 幹事
------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------------

●プリント配線板UL規格運用意見交換会 無料

●日 時：6月1日(木) ●会 場：セミナー会場B

1日(木)	15:00-16:00	プリント配線板UL規格運用意見交換会	酒井 和英 (株)UL Japan コンシューマー機器事業部 オペレーションズグループ
-------	-------------	--------------------	---

共催セミナー 無料

● E-Textile/Wearableセミナー

●日 時：5月31日(水) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：10名

31日(水)	14:00-16:00	E-Textileアプリケーション策定に向けたワイガヤ座談会進捗報告セミナー 才脇 直樹 奈良国立大学機構 奈良カレッジ連携推進センター 教授・センター長 / 大阪大学 大学院基礎工学研究科 特任教授
--------	-------------	---

● E-Textile/Wearable実装技術セミナー

●日 時：6月1日(木) ●会 場：セミナー会場B ●聴講者数：29名

1日(木)	15:45-16:30	JOHNAN(株)が取り組む機能性フィルム実装開発(ストレッチャブル実装、紙実装その他) 松田 良成 コムスキャンテクノ(株) 代表取締役 / JOHNAN(株) 執行役員
-------	-------------	---

● 2023 半導体・オブ・ザ・イヤー2023

●日 時：5月31日(水) ●会 場：セミナー会場G

「半導体・オブ・ザ・イヤー2023」は、半導体デバイス部門、半導体製造装置部門、半導体用電子材料部門で選定いたしました。

【半導体デバイス部門】		
グランプリ	キオクシア(株)、Western Digital Corporation	「高度なスケールリング技術とウェーハボンディング技術を採用した218層3次元フラッシュメモリ」
優秀賞	ルネサス エレクトロニクス(株)	xEV向けインバータ用新世代パワー半導体Si IGBT
優秀賞	佐賀大学、Orbray(株)	「ダイヤモンド半導体パワーデバイスの世界最高の出力電力・電圧」
【半導体製造装置部門】		
グランプリ	(株)ニューフレアテクノロジー	3nm+ノード世代の半導体製造用マスク量産に対応したマルチ電子ビームマスク描画装置「MBM™-2000PLUS」
優秀賞	(株)SCREENセミコンダクターソリューションズ	次世代パワーデバイス向けウエハー外観検査装置「ZI-3600」
優秀賞	東レエンジニアリング(株)	マイクロLED転写装置「MT3000L」の開発とマイクロLEDディスプレイ製造のトータルソリューションの展開
【半導体用電子材料部門】		
グランプリ	大日本印刷(株)	「次世代半導体パッケージ向け「TGVガラスコア基板」
優秀賞	(株)レゾナック	SiCハイグレードエビ第3世代品を開発、量産を開始
優秀賞	(株)ダイセル	半導体を守る「ナノひつつき虫」

interOpto/Imaging Japan関連セミナー 無料

● interOpto/Imaging Japan 次世代通信に向けた光電融合技術セミナー

●日 時：6月1日(木) ●会 場：セミナー会場J ●聴講者数：298名

6月1日(木)	13:00-13:50	Society5.0時代の大容量情報通信を支える光・電波融合デバイス・システム基盤技術 山本 直克 (国研)情報通信研究機構 ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター・副センター長 / 先端ICTデバイスラボ・ラボ長(兼任)
	13:50-14:30	光電融合を支えるハイブリッド光デバイスの開発 ～光電技術を活用したデバイスにおける信号処理の一部を担うフォトニクスとプラズモニクスを融合したハイブリッド光デバイスの開発～ 岡本 浩行 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授
	14:30-15:10	集積光コム光源(マイクロコム)と通信への応用 久世 直也 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 次世代光研究部門 准教授
	15:10-15:40	フォトニックサイエンステクノロジー社のファイバー製造技術とファイバ部品開発技術 小林 壮一 フォトニックサイエンステクノロジー(株) 代表取締役社長

● interOpto/Imaging Japan 計測・分析・解析技術セミナー

●日 時：6月1日(木) ●会 場：セミナー会場J ●聴講者数：108名

6月1日(木)	11:15-11:45	カメラを用いた検査システムやセキュリティシステムの設計にも役立つ光学シミュレーション技術 大橋 祐介 サイバネットシステム(株) デジタルエンジニアリング事業本部 エンジニアリング事業部 オプティカル技術部
	11:45-12:15	3D外観検査のためのレーザ構造化照明を実現するDOE技術 川島 勇人 (株)スペースフロン 代表取締役

●テラヘルツテクノロジーフォーラム

●日 時：5月31日(水) ●会 場：セミナー会場J ※展示会場+ Zoom 配信 (ハイブリッド開催) ●聴講者数：529名 (オンライン参加聴講者90名含む)

5月31日(水)	13:00-13:05	開会あいさつ/プログラム案内	林 伸一郎 テラテックフォーラム (情報通信研究機構) 戦略企画委員長
	13:05-13:35	THz (300GHz) 対応 Beyond5G/6G 向けアンテナ計測と空間電波可視化技術	杉山 武史 (株)フォトニックエッジ 代表取締役
	13:35-13:55	テラヘルツ波計測システムとコンポーネント	深澤 亮一 (有)スペクトルデザイン 代表取締役
	13:55-14:25	走査型テラヘルツ波点光源顕微鏡の開発とがん病理診断応用	芹田 和則 大阪大学 経営企画オフィス 准教授
	14:25-14:45	Beyond 5G に向けた材料・デバイスの周波数特性計測システムのご紹介	加藤 英志 (株)アドバンテスト 新事業推進室 マネージャー
	14:45-15:05	300GHzウォークスルーボディースキャナーの開発	大谷 知行 (国研) 理化学研究所 チームリーダー
	15:05-15:35	テラヘルツ無線技術による身体近位空間の計測と通信	門内 靖明 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 准教授
	15:35-15:50	まとめ+NICTフレームワーク	齋藤 伸吾 情報通信研究機構 (テラテックフォーラム) 主任研究員

●interOpto/Imaging Japan スマートライフ向け光デバイス最新動向セミナー

●日 時：6月2日(金) ●会 場：セミナー会場J ●聴講者数：100名

6月2日(金)	11:10-11:40	最新 CMOS プロセス設計技術のスマートライフへの応用可能性	Jan Vermeiren Caeleste CVBA
	11:40-12:10	GaN系赤色LEDの高効率化にむけて	鈴木 敦志 E&E evolution(株) 代表取締役

●interOpto/Imaging Japan スマートファクトリー向けカメラ・センサー・システム最新技術セミナー

●日 時：6月2日(金) ●会 場：セミナー会場J ●聴講者数：115名

6月2日(金)	13:00-13:30	"How Photons Transform Industries" ("光は産業をどう変えるか")	Murali Kumar Luminous Devices (presented by 丸文) Business Line Director, Non-Visible Products
	13:30-14:00	可視光波長"外"の画像情報を実用するには	中村 心哉 Xenics Japan カントリーマネージャー

●注目される光技術セミナー

●日 時：5月31日(水)～6月2日(金) ●会 場：セミナー会場J ●聴講者数：238名

5月31日(水)	10:35-10:55	<光計測による運動能力計測装置> ～近赤外線LEDとフォトICを並べ、初心者からトップアスリートの運動能力を時間分解能 1mSec でリアルタイムに計測する～	(株)Stella
	10:55-11:15	深紫外線LEDに対する光学部品を用いた最適な光の照射とその応用	(株)大興製作所
	16:10-16:30	視線追跡システムを用いたストレスフリーなコミュニケーションの開発	(株)オレンジアーチ
6月1日(木)	16:00-16:20	光パターン形成LED照明「ホロライト・シリーズ」～安心安全・面白い・新しい光の使い方～	バイフォニクス(株)
	16:20-16:40	ドット受光ICが実現する高速・高S/Nセンシング	マイクロシグナル(株)
6月2日(金)	14:50-15:10	人の目のような視覚システムを実現するLiDAR	(株)SteraVision
	15:10-15:30	小型、高精度な血液、液体、体液の光学センシング	ジーニアルライト(株)
	15:30-15:50	安全性を確保し、教育ツールとしても使えるレーザー溶接用電子ゴーグルの開発について	芝原工業(株)

●車載向けレーザ加工最新動向

●日 時：6月1日(木) ●会 場：セミナー会場L ●聴講者数：130名

6月1日(木)	13:00-13:40	E-mobility時代における自動車部品へのレーザ加工技術適用及び最新技術動向	白井 秀彰 (株)デンソー 先進プロセス研究部 機能創成研究2室 Project General Manager
	13:40-14:20	EVへの適用が広がる高出力ブルーレーザ及び最新半導体レーザ加工	武田 晋 レーザライン(株) 代表取締役社長

●interOpto/Imaging Japan 企業プレゼンテーション

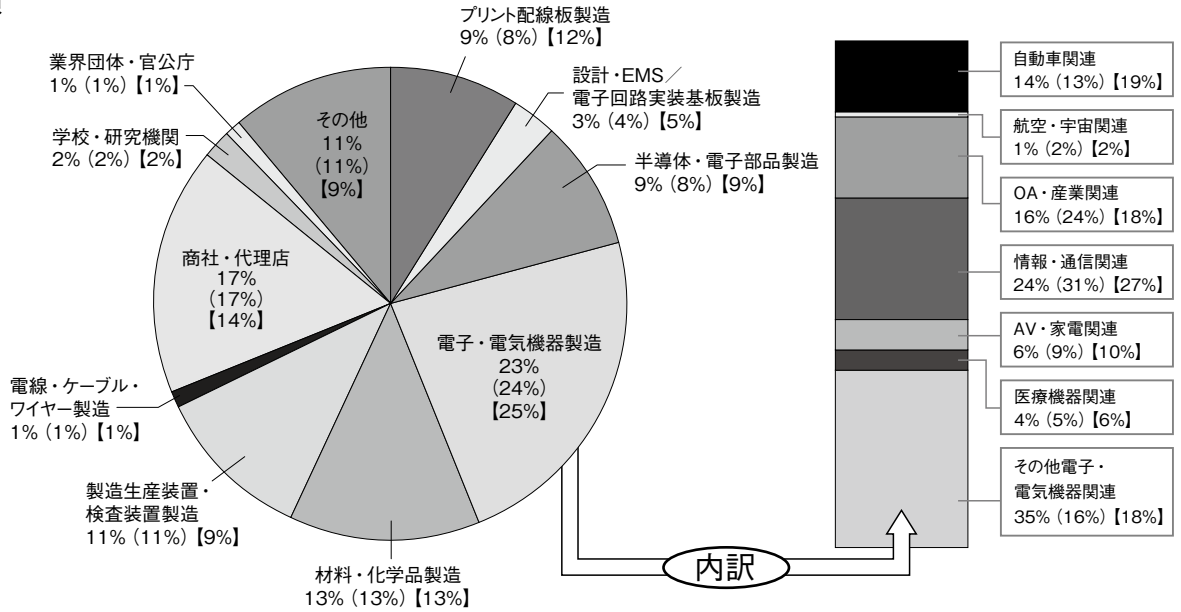
●日 時：5月31日(水)・6月1日(木) ●会 場：セミナー会場J ●聴講者数：58名

5月31日(水)	11:30-11:50	独国APE社製 高性能スキャニングオートコリレータ pulseCheckシリーズのご紹介	フォトテクニカ(株)
	12:05-12:25	銅炭素複合材料による次世代オプトエレクトロニクスデバイスの放熱設計への展開	UBE(株)
6月1日(木)	10:30-11:00	同時多波長測定を可能にするポリクロメータ式 光スベアナのご紹介	(株)島津製作所

全展示会実績

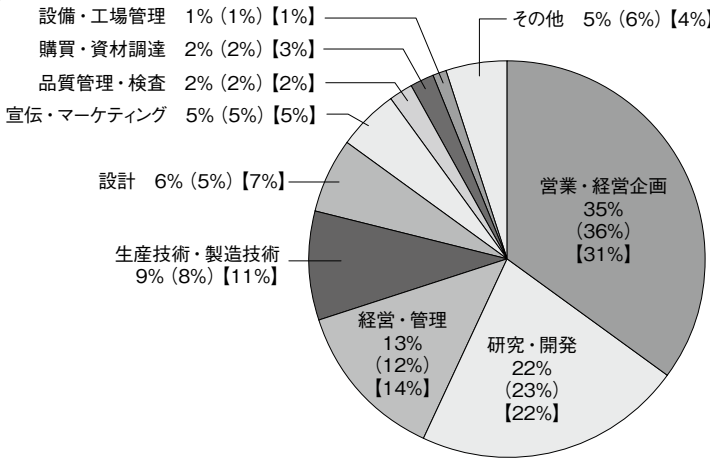
①来場者の業種分類

() 2022年展示会数値
【 】2019年展示会数値



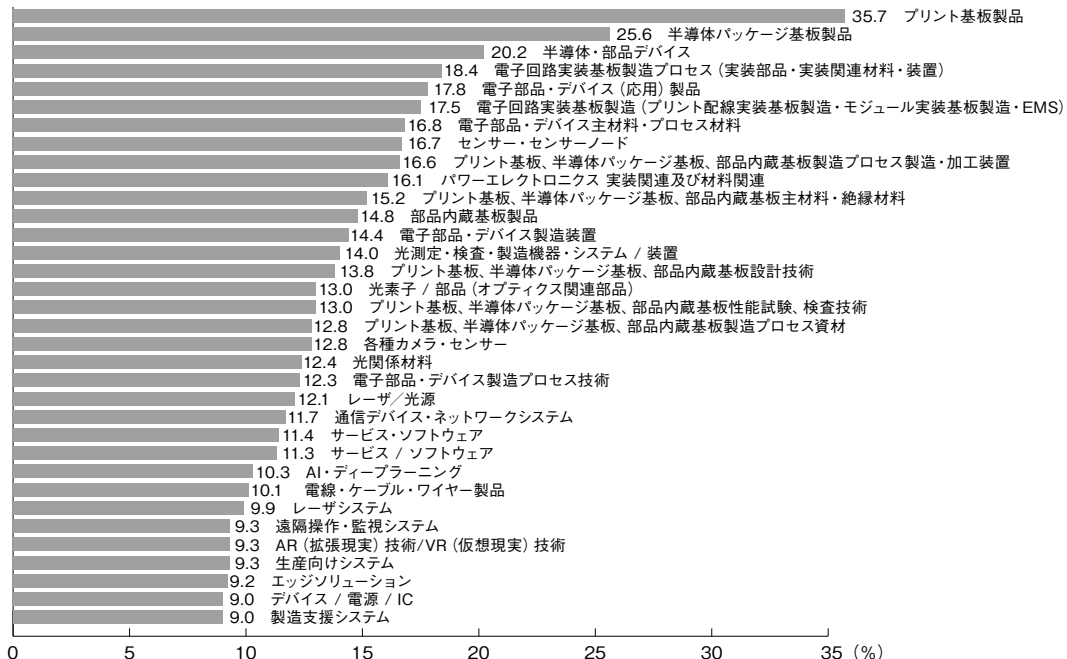
②来場者の職種分類

() 2022年展示会数値
【 】2019年展示会数値

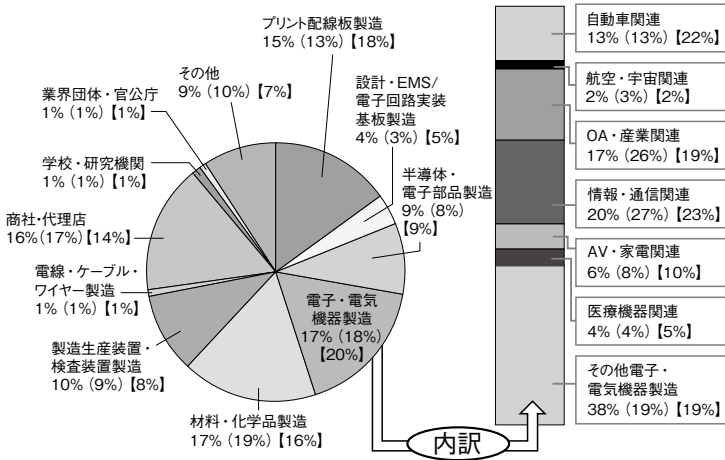


本展は総合展示会のため電子機器に関する幅広い業種の方々に来場いただき、なかでも電子・電気機器製造の方が多い。特に電子・電気機器製造の中でも『その他』の方が前回よりも多く、より来場者層の幅が広がっていることが見受けられる。
また、製品分類においては、プリント配線板製品、半導体パッケージング製品への関心度が高い。

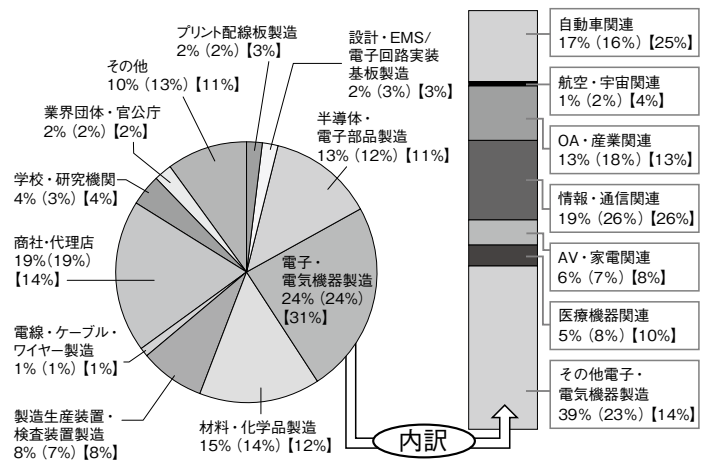
③来場者が関心のある製品分類 ※複数回答



JPCA Show 2023 () 2022 年展会数値
【 】2019 年展示会数値

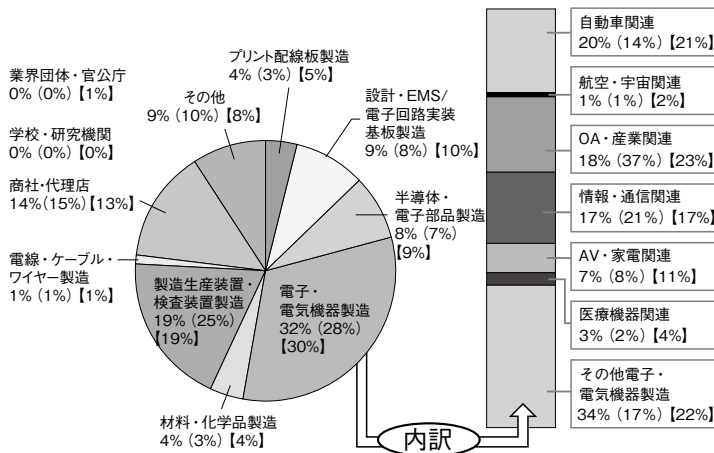


2023 マイクロエレクトロニクスショー () 2022 年展会数値
【 】2019 年展示会数値



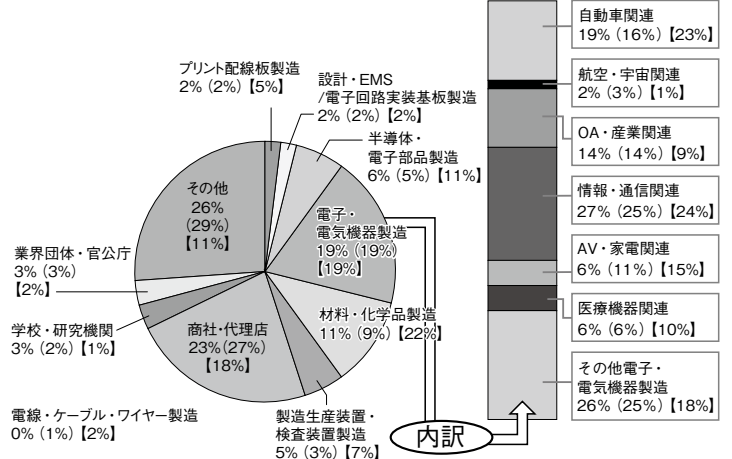
JISSO PROTEC 2023

() 実装関連展 2022 数値
【 】JISSO PROTEC 2019 数値

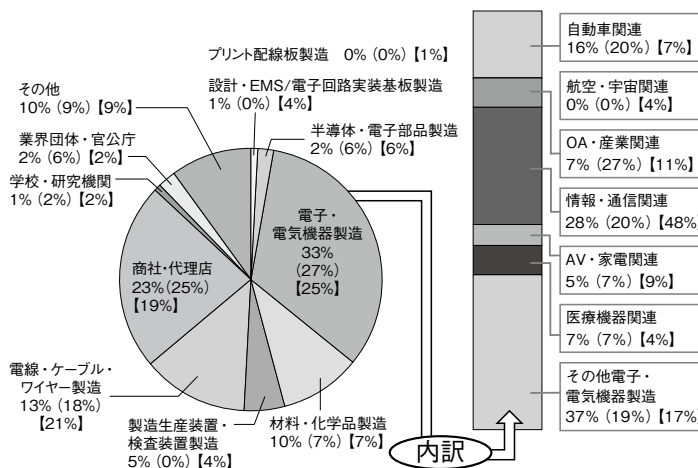


SDGs デバイス展 2023

() 有機デバイス総合展 2022 数値
【 】有機デバイス総合展 2019 数値

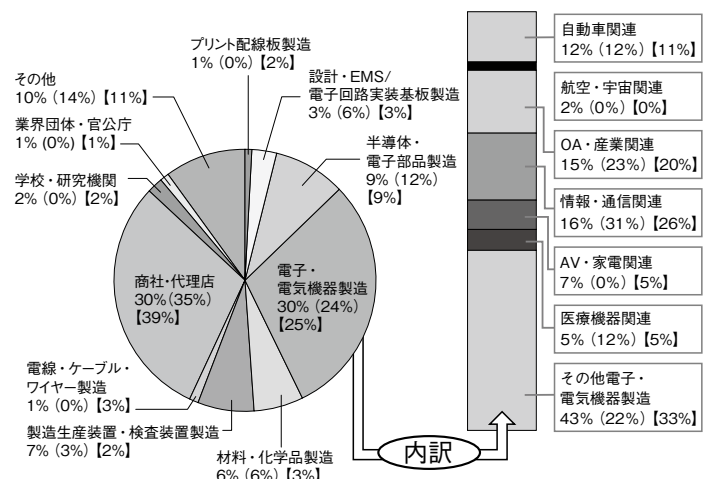


WIRE Japan Show 2023 () 2022 年展会数値
【 】2019 年展示会数値



Electronics Component & Unit Show () 2022 年展会数値
【 】2019 年展示会数値

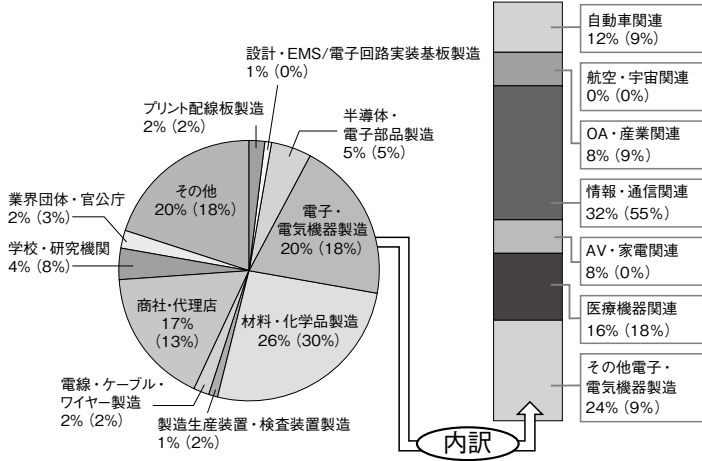
※上記数値は JEP/TEP Show より



来場者分析

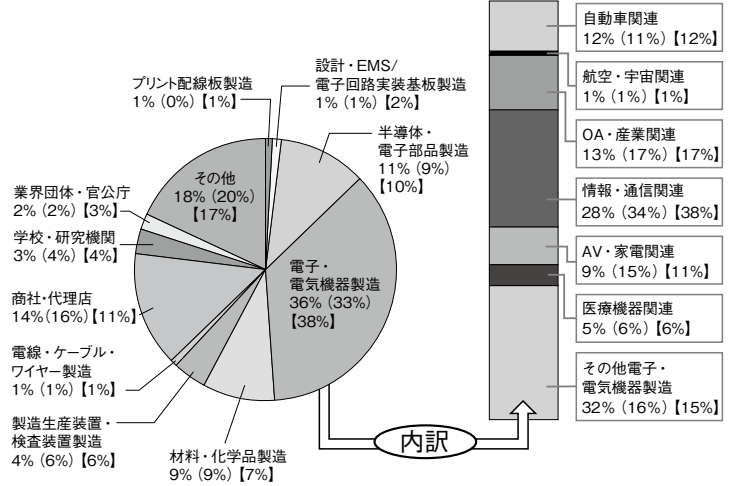
E-Textile/Wearable

() 2022 年展示会数値
※ 2021 年より開催



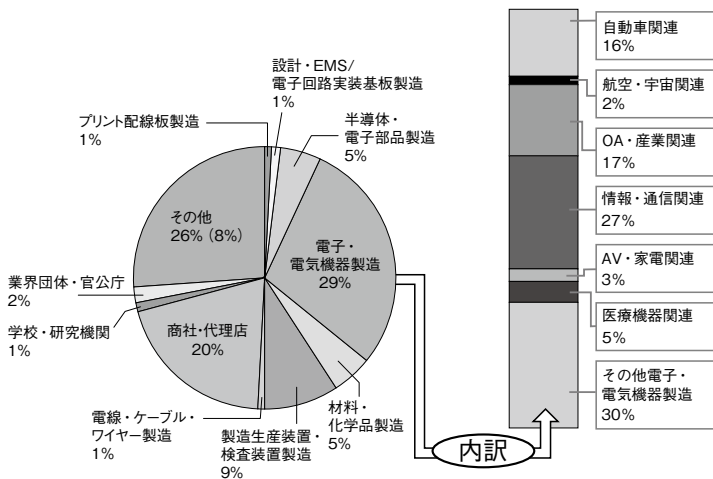
Smart Sensing 2023

() 2022 年展示会数値
【 】 2019 年展示会数値



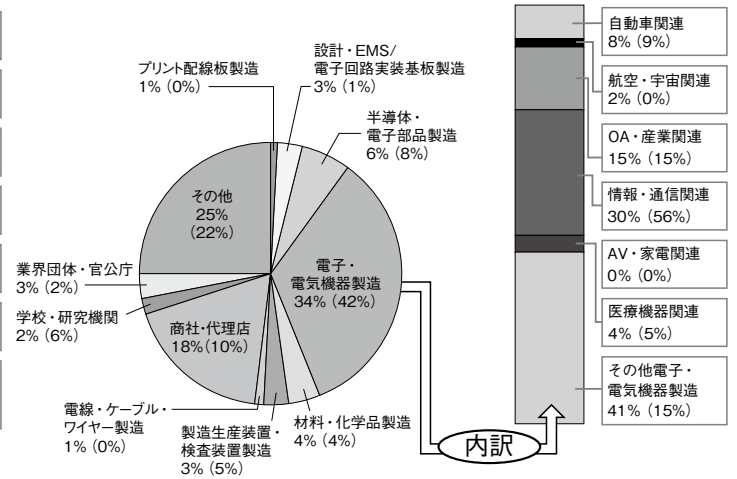
無人化ソリューション展

※ 2023 年より開催



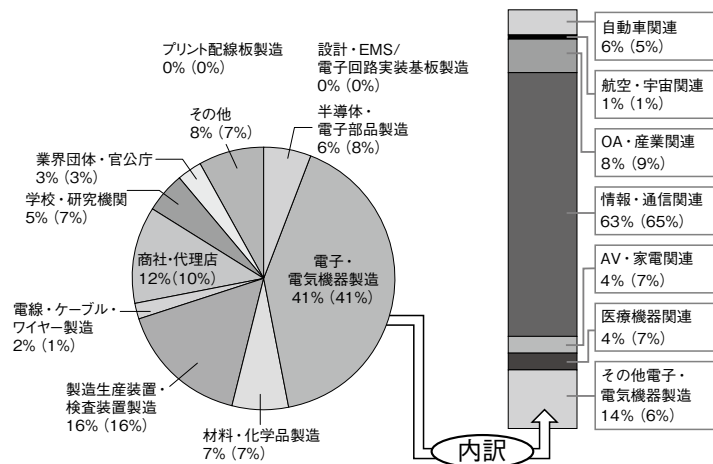
Edge Computing

() 2022 年展示会数値
※ 2021 年より開催



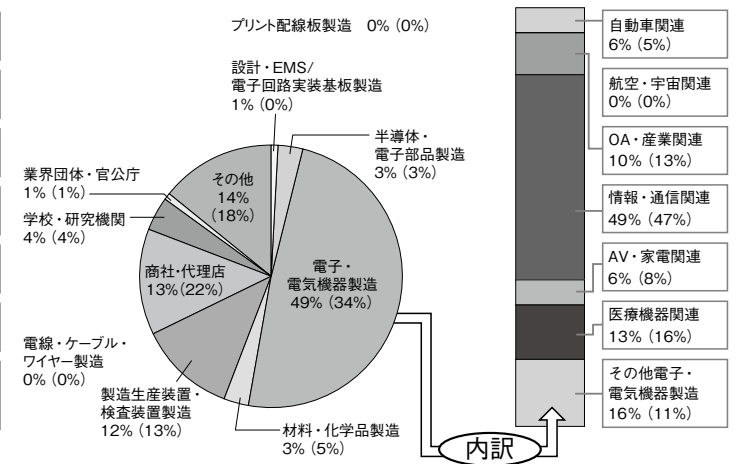
InterOpto®

() 2022 年展示会数値
※ 2021 年より開催



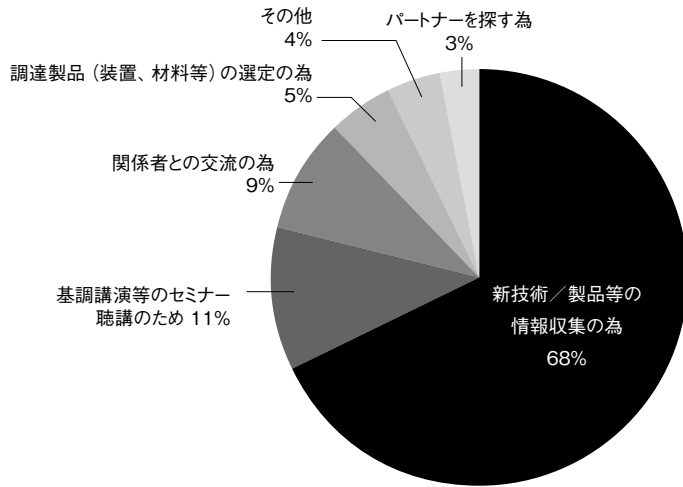
Imaging Japan

() 2022 年展示会数値
※ 2021 年より開催

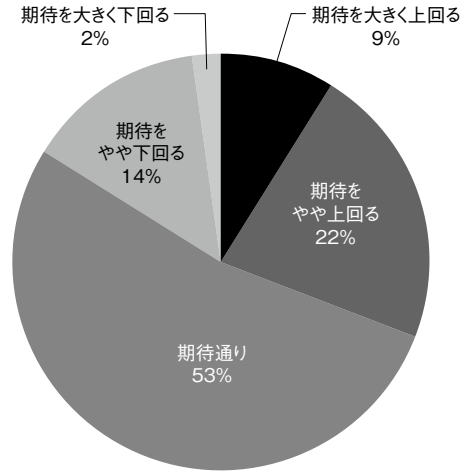


来場者アンケート

① 来場目的

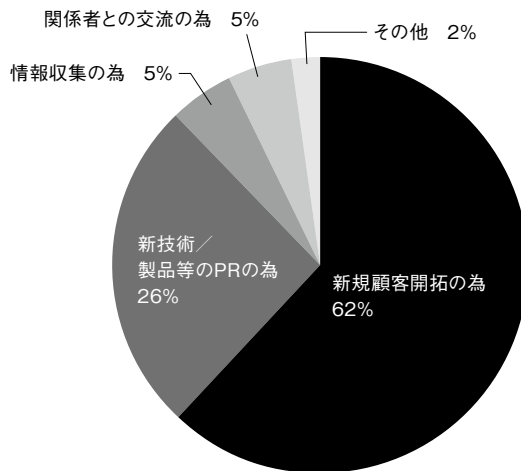


② 来場成果

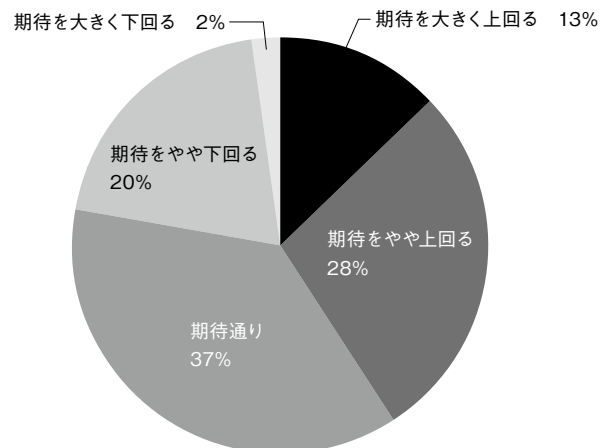


出展者アンケート

① 出展目的



② 出展成果



2023年展示会主催・運営委員会 委員

2023展示会運営委員会

委員長	山本 治彦 展示会企画委員長/JPCA顧問 (超高効率電子回路生産システム研究会)
副委員長	児嶋 一登 JPCA 副会長/㈱京写
副委員長	小島 正紀 JPCA 副会長/ニッカン工業㈱
委員	猪川 幸司 JIEP 展示会運営委員会委員長/日本シイエムケイ㈱
委員	北口 浩嗣 JISSO PROTEC 2023 運営委員会 委員長/ JUKIオートメーションシステムズ㈱
委員	泉谷 渉 SDGsデバイス展共催会社会長/ ㈱産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)
委員	井上 政基 WIRE Japan Show 共催会社社長/㈱工業通信(電線新聞)
委員	長谷川 裕久 Smart Sensing 共催会社代表/ ㈱JTBコミュニケーションデザイン
委員	川鍋 季明 Electronics Component & Unit Show 共催団体代表/ ㈱三共社
委員	藤浦 修一 E-Textile/Wearable 共催会社代表/㈱織研新聞社

展示会企画委員会

委員長	山本 治彦 展示会運営委員長/JPCA顧問 (超高効率電子回路生産システム研究会)
副委員長	ジュリアン・ベイショア JPCA 理事/ マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ ジャパン㈱
副委員長	小島 正紀 JPCA 副会長/ニッカン工業㈱
委員	猪川 幸司 JIEP 展示会運営委員会委員長/ 日本シイエムケイ㈱
委員	上田 裕司 JISSO PROTEC 2023 実行委員会・ 企画部会 委員長/ JUKIオートメーションシステムズ㈱
委員	泉谷 渉 SDGsデバイス展共催会会長/ ㈱産業タイムズ社(電子デバイス産業新聞)
委員	井上 政基 WIRE Japan Show 共催会社社長/ ㈱工業通信(電線新聞)
委員	長谷川 裕久 Smart Sensing 共催会社代表/ ㈱JTBコミュニケーションデザイン
委員	鶴田 哲司 Electronics Component & Unit Show 代表/ ツルタ制御機器㈱
委員	藤浦 修一 E-Textile/Wearable 共催会社代表/ ㈱織研新聞社

JIEP 展示会運営委員会

委員長	猪川 幸司 日本シイエムケイ㈱
副委員長	越地 福朗 東京工芸大学
	渡部 美子 (一社)日本電子回路工業会
	佐藤 牧子 ナミックス㈱
委員	松本 博文 フレックスリンクテクノロジー㈱
	土門 孝彰 秋田銀行
	三宅 敏広 ㈱デンソー
	高野 希 日立化成㈱
	加藤 義尚 福岡大学
	齊藤 雅之 元㈱東芝
	西田 秀行 ニシダエレクトロニクス実装技術支援
	池田 浩昭 日本航空電子工業㈱
	中條 徳男 ㈱日立製作所
	本多 進 C-NET
	和嶋 元世 C-NET
	渡邊 裕彦 富士電機㈱
	谷 元昭 T2リサーチ
	伊藤 寿浩 東京大学
	内木場文男 日本大学
	小岩 一郎 関東学院大学
	澤田 廉士 Palmens㈱
	白石 洋一 群馬大学
	金谷 春一 九州大学

実装プロセステクノロジー展運営委員会

委員長	北口 浩嗣 JUKIオートメーションシステムズ㈱
副委員長	富士原 寛 (一社)日本ロボット工業会
委員	太田 裕之 ヤマハ発動機㈱
	秋山 昭博 パナソニックコネクタ㈱
	曾我 信之 ㈱FUJI

実装プロセステクノロジー展実行委員会

委員長	上田 裕司 JUKIオートメーションシステムズ㈱
副委員長	吉川 英樹 ヤマハ発動機㈱
委員	杉友 庸一 パナソニックコネクタ㈱
	武野 祐丸 ㈱FUJI
	中村 徳臣 武蔵エンジニアリング㈱
	小島 新也 オムロン㈱

実装プロセステクノロジー展企画部会

委員長	上田 裕司 JUKIオートメーションシステムズ㈱
副委員長	吉川 英樹 ヤマハ発動機㈱
委員	杉友 庸一 パナソニックコネクタ㈱
	武野 祐丸 ㈱FUJI

JPCA2024
Show

第53回国際電子回路産業展



マイクロエレクトロニクスショー

第38回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO
PROTEC 2024

第25回 実装プロセステクノロジー展



SDGeデバイス展



電気・光伝送技術展

Electronics
Component & Unit
Show

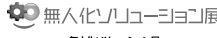
JPCA 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable

イーテキスタイル/ウェアラブル展



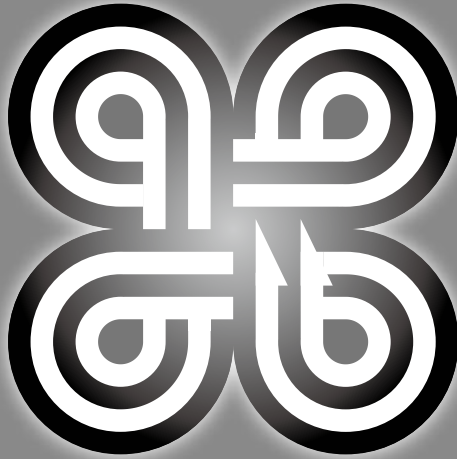
スマートセンシング



無人化ソリューション展



エッジコンピューティング



電子機器2024 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2024

2024.6.12 Wed. → **14** Fri.

東京ビッグサイト 東展示棟 | Tokyo Big Sight, East Exhibition Hall

本部事務局 一般社団法人 日本電子回路工業会 ▼展示会に関するお問い合わせ / Inquiry ▼
Organized by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association 本部事務局: 一般社団法人日本電子回路工業会 Organized by: Japan Electronics Packaging and Circuits Association
TEL: 03-5310-2020 E-mail: show@jpca.org

www.jpca.org

詳細は展示会ウェブサイトへ ▶ www.jpca.org

▶ お問い合わせ先 展示会運営事務局: 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 12F
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp

本部事務局:
一般社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org